

*Hypersonic*

股票代碼：7894

# 瀚軒股份有限公司

HYPERSONIC INC.

# 114 年報

刊印日期：中華民國 115 年 4 月 23 日

年報查詢網址

公開資訊觀測站網址：<http://mops.twse.com.tw>

本公司網址：<http://www.hpc.com.tw>

**一、公司發言人：**

姓名：陳國烘

職稱：總經理特助

電話：(03)461-1902

電子郵件信箱：scott\_chen@hpc.com.tw

**代理發言人：**

姓名：邱哲儀

職稱：副總經理

電話：(03)461-1902

電子郵件信箱：jerry\_chiu@hpc.com.tw

**二、總公司、分公司、工廠之地址及電話：**

公司/工廠	地址	電話
總公司	桃園市中壢區中華路二段 209 號	(03)461-1902
工廠及分公司	南科科學園區高雄市路竹區路科五路 82 號 3 樓	(07)695-5112

**三、辦理股票過戶機構名稱、地址、電話及網址：**

名稱：華南永昌綜合證券股份有限公司

地址：台北市民生東路四段 54 號 4 樓

電話：(02)2718-6425

網址：<https://www.entrust.com.tw>

**四、最近年度財務報告簽證會計師姓名、事務所名稱、地址、電話及網址：**

姓名：陳依玲會計師、陳燦煌會計師

名稱：日正聯合會計師事務所

地址：台北市松山區復興北路 33 號 2 樓

電話：(02)2751-0306

網址：<http://www.nexia.com.tw>

**五、海外有價證券掛牌買賣之交易場所名稱及查詢該海外有價證券之方式：**

無

**六、公司網址：<http://www.hpc.com.tw>**

# 目 錄

<b>壹、致股東報告書</b> .....	<b>4</b>
一、114 年度營業結果.....	4
二、115 年度營業計畫概要.....	5
三、未來公司發展策略、受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響.....	6
<b>貳、公司治理報告</b> .....	<b>7</b>
一、董事、監察人、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料.....	7
二、最近年度給付董事、監察人、總經理及副總經理等之酬金.....	13
三、公司治理運作情形.....	17
四、簽證會計師公費資訊.....	30
五、更換會計師資訊.....	30
六、公司之董事長、總經理、負責財務或會計事務之經理人，最近一年內曾任職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業.....	30
七、最近年度及截至年報刊印日止董事、監察人、經理人及持股比例超過百分之十之股東股權移轉及股權質押變動情形.....	30
八、持股比例占前十名之股東，其相互間為關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係之資訊.....	32
九、公司、公司之董事、監察人、經理人及公司直接或間接控制之事業對同一轉投資事業之持股數，並合併計算綜合持股比例.....	32
<b>參、募集情形</b> .....	<b>33</b>
一、股本來源.....	33
二、主要股東名單.....	34
三、公司股利政策及執行狀況.....	35
四、本次股東會擬議之無償配股對公司營業績效及每股盈餘之影響.....	35
五、員工、董事及監察人酬勞.....	35
六、公司買回本公司股份情形.....	36
七、公司債辦理情形.....	36
八、特別股辦理情形.....	36
九、海外存託憑證辦理情形.....	36
十、員工認股權憑證辦理情形.....	37
十一、限制員工權利新股辦理情形.....	38
十二、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形.....	38
十三、資金運用計畫執行情形.....	38
<b>肆、營運概況</b> .....	<b>39</b>
一、業務內容.....	39
二、市場及產銷概況.....	56
三、最近二年度及截至年報刊印日止從業員工資料.....	61

四、環保支出資訊.....	62
五、勞資關係.....	62
六、資通安全管理.....	64
七、重要契約.....	65
<b>伍、財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項 .....</b>	<b>67</b>
一、財務狀況.....	67
二、財務績效.....	68
三、現金流量.....	68
四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響.....	69
五、最近年度轉投資政策、其獲利或虧損之主要原因、改善計畫及未來一年投資計畫.....	69
六、風險事項.....	70
七、其他重要事項.....	76
<b>陸、特別記載事項 .....</b>	<b>77</b>
一、關係企業相關資料.....	77
二、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形.....	77
三、其他必要補充說明事項.....	77
四、最近年度及截至年報刊印日止，如發生本法第三十六條第三項第二款所定對股東 權益或證券價格有重大影響之事項.....	77

# 壹、致股東報告書

各位股東先生、女士：

歡迎各位撥冗參加本年度股東會，在此謹代表公司誠摯的感謝各位股東過去一年對瀚軒的支持與鼓勵。茲將 114 年度之經營狀況及未來展望報告如下：

## 一、114 年度營業結果

### (一)114 年度營業計畫實施成果

本公司 114 年合併營收淨額新台幣 1,347,136 仟元，較 113 年 1,301,864 仟元增加 3.48%，114 年合併稅後淨利為 93,352 仟元，較 113 年 122,257 仟元減少 23.64%。

### (二)預算執行情形

本公司及子公司 114 年度未公開財務預測，故無預算達成情形。

### (三)財務收支及獲利能力分析

單位：新臺幣仟元

項 目		年 度		
		114 年度	113 年度	增(減)%
財 務 收 支	營業收入淨額	1,347,136	1,301,864	3.48%
	營業毛利	543,572	536,702	1.28%
	營業淨利	142,727	168,004	(15.05%)
	稅後淨利	93,352	122,257	(23.64%)
獲 利 能 力	資產報酬率(%)	9.87%	15.92%	(38.00%)
	股東權益報酬率(%)	20.43%	34.45%	(40.70%)
	營業利益占實收資本額比率(%)	67.64%	114.13%	(40.73%)
	稅前純益占實收資本額比率	74.39%	122.01%	(39.03%)
	純益率(%)	6.93%	9.39%	(26.20%)
	每股盈餘(元)	追溯前	4.50	8.31
追溯後		4.50	5.93	(24.11%)

註：以上係 114 及 113 年合併財務報表資料

#### (四)研究發展狀況

本公司最近二年度研究發展支出及研發費用占當年度營業收入比例如下：

單位：新臺幣仟元

項 目	114 年度	113 年度
研發費用	24,109	26,050
佔營收比例(%)	1.79%	2.00%

本公司長期投入半導體封裝與測試相關設備與技術之整合應用，除持續引進國際先進封裝測試設備與材料外，亦積極發展自有自動化設備技術，以提升產品附加價值與服務能力。

隨著人工智慧、高效能運算及先進封裝技術之快速發展，半導體產業對於封裝測試設備與材料之需求將持續提升。本公司未來將持續強化技術整合能力、深化產品應用領域及提升服務品質，以鞏固公司在半導體產業供應鏈中的競爭優勢。

在半導體客製自動化設備與水滴角量測領域持續投入，並擴展可應用產品，如 COWOS 晶圓等，持續與業界先進的綜合製造商合作全自動化，無人搬運之上下料設備，進一步提升封裝廠的無人化進程。

## 二、115 年度營業計畫概要

### (一)經營方針

隨著全球半導體產業持續快速發展，產業競爭已由過往單純的品質、技術與成本競爭，逐步提升至全球供應鏈整合、技術合作及資源整合能力之綜合競爭。本公司長期深耕半導體封裝與測試相關產業，並透過產品代理、自有設備研發及技術服務整合，提供客戶完整之技術支援與解決方案。

本公司秉持「長期、穩定、發展、科技、國際」之經營理念，持續深化在半導體產業鏈中的專業能力，並透過強化產品組合、拓展市場布局及提升服務品質，以提升整體競爭優勢與市場地位，進而為股東創造長期穩定之價值。

### (二)預期銷售數量及其依據

本公司及子公司無公開財務預測，故不適用。

### (三)重要產銷政策

114 年度全球經濟環境仍持續受到地緣政治風險、國際貿易政策變動及利率政策調整等因素影響，半導體產業亦面臨景氣循環及客戶資本支出調整之影響。然而隨著人工智慧 (AI)、高效能運算 (HPC)、先進封裝及高速運算晶片需求持續成長，半導體產業長期發展趨勢仍維持穩健。

本公司主要服務半導體封裝與測試產業客戶，透過代理國際知名設備與材料品牌，並結合自有設備產品，提供客戶完整之製程解決方案。面對產業環境變化，本公司持續調整產品策略並深化客戶合作關係，以維持營運穩定發展。

### 三、未來公司發展策略、受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響

展望未來，本公司將持續推動以下發展策略：

(一)深化半導體封裝測試市場布局

持續深耕既有客戶群並拓展新客戶，提升市場占有率。

(二)強化產品與技術整合能力

透過代理產品與自有設備整合服務模式，提供客戶更完整的解決方案。

(三)拓展高成長應用領域

積極布局人工智慧、高效能運算及先進封裝相關產業應用。

(四)持續提升營運效率與組織競爭力

透過組織管理與營運流程優化，提升整體營運效率與服務品質。

114 年度整體營運受市場需求波動影響，大陸子公司瀚發公司之投資收益較 113 年度減少 32,448 仟元，致本年度稅後淨利較前一年度下降，惟本公司已持續透過營運管理效率提升及成本控管，使營業利益仍維持穩定水準，整體而言，本公司財務結構仍維持穩健，具備持續發展之基礎，持續提供客戶具高附加價值的前瞻性解決方案，同時強化公司治理，建立有效之內控環境以因應外在經營環境之變化，追求合理化為顧客、股東和員工創造三贏的結果。

敬祝 各位股東

身體健康 萬事如意

瀚軒股份有限公司



董事長:林斯穎



## 貳、公司治理報告

### 一、董事、監察人、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料

#### (一) 董事及監察人資料

115年4月23日

職稱	國籍或註地	姓名	性別 年齡	選(就)任 日期	任期	初次選任 日期	選任時持有股份		現在持有股數		配偶、未 成年子女 現在持有 股份		利用他人 名義持有 股份		主要經 (學)歷	目前兼任本公司及其他 公司之職務	具配偶或 二親等以 內關係之 其他主 管、董事 或監察人			備註
							股數	持 股 比 率	股數	持 股 比 率	股數	持 股 比 率	股數	持 股 比 率			職 稱	姓 名	關 係	
董事長	中華民國	林斯穎	男 71~80 歲	113.12.16	3年	76.07.24	3,404,157	23.13%	3,855,819	18.27%	-	-	-	-	●陽明交通大學電信工程 系	●恆軒投資(股)公司監察 人	業務副 理	林大 為	一親 等	-
董事	中華民國	陳文冠	男 51~60 歲	113.12.16	3年	89.05.11	198,909	1.35%	287,493	1.36%	-	-	-	-	●陽明交通大學資訊工程 學系	●瀚發貿易(上海)有限公 司董事長 ●翌驛實業(股)公司董事 ●冠兆投資(股)公司董事 長	-	-	-	-
董事	中華民國	林逸羣	男 51~60 歲	113.12.16	3年	113.12.16	512,947	3.48%	733,125	3.47%	-	-	-	-	●遠東紡織業務課長 ●美國曼菲斯大學商學院 碩士 ●台灣大學大氣科學系	-	-	-	-	
董事	中華民國	張添昌	男 51~60 歲	115.02.11	3年	115.02.11	-	-	-	-	-	-	-	-	●大芯科技(股)公司總經 理 ●大云永續科技(股)公司 資深合夥人 ●中央大學電機所	●大芯科技(股)公司總經 理 ●大云永續科技(股)公司 資深合夥人 ●祐鈿科技有限公司董事 ●祐萊投資有限公司董事 ●維薰有限公司董事 ●可久(股)公司監察人	-	-	-	-

職稱	國籍或註地	姓名	性別年齡	選(就)任日期	任期	初次選任日期	選任時持有股份		現在持有股數		配偶、未成年子女現在持有股份		利用他人名義持有股份		主要經(學)歷	目前兼任本公司及其他公司之職務	具配偶或二親等以內關係之其他主管、董事或監察人			備註
							股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率			職稱	姓名	關係	
獨立董事	中華民國	劉慧儀	女 41~50歲	115.02.11	3年	115.02.11	-	-	-	-	-	-	-	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>•台亞風能(股)公司營運管理總監</li> <li>•證券櫃檯買賣中心上櫃審查部專員</li> <li>•會計師高考及格</li> <li>•台灣大學商學系</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•亞洲新能源(開曼)(股)公司董事兼營運管理總監</li> <li>•台亞風能(股)公司法人董事代表人</li> <li>•台灣銘板股份有限公司獨立董事</li> </ul>	-	-	-	-
獨立董事	中華民國	洪欣儒	女 41~50歲	115.02.11	3年	115.02.11	-	-	-	-	-	-	-	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>•理律法律事務所資深律師</li> <li>•台灣律師執照及美國紐約州律師資格</li> <li>•美國紐約大學法律系LLM</li> <li>•台灣大學法律系</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•緯鴻顧問有限公司董事長</li> <li>•緯鴻眾理法律事務所主持律師</li> <li>•軒郁國際(股)公司獨立董事</li> </ul>	-	-	-	-
獨立董事	中華民國	胡瑞卿	女 51~60歲	115.02.11	3年	115.02.11	-	-	-	-	-	-	-	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>•漢民科技(股)公司策略投資副總經理</li> <li>•漢民科技(股)公司新事業發展副總經理</li> <li>•潘杰(股)公司董事長兼總經理</li> <li>•漢民微測科技(股)公司新事業發展副總經理</li> <li>•美商英特爾-intel Capital 總監</li> <li>•美國史丹佛大學運籌管理系碩士</li> <li>•交通大學 EMBA</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•醫智亮加速器(股)公司董事兼執行長</li> <li>•家碩科技(股)公司董事</li> <li>•豫坤投資有限公司董事</li> <li>•瑞大生技投資管理顧問(股)公司董事</li> <li>•公信電子(股)公司獨立董事</li> </ul>	-	-	-	-

(二)法人股東之主要股東

115年4月23日

法人股東名稱	法人股東之主要股東
—	—

(三)主要股東為法人者其主要股東

115年4月23日

法人名稱	法人之主要股東
—	—

(四)董事及監察人專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露

姓名	條件 專業資格與經驗(註1)	獨立性情形	兼任其他公開發行公司獨立董事家數
董事長 林斯穎	具有三十年以上公司業務所需之工作經驗，目前擔任本公司董事長	本公司董事間，並無違反「證券交易法」有關獨立性規範之情事，亦未有公司法第30條各款情事。	—
董事 陳文冠	具有三十年以上公司業務所需之工作經驗		—
董事 林逸羣	具有二十五年以上公司業務所需之工作經驗		—
董事 張添昌	具有二十五年以上半導體相關業務所需之工作經驗		—
獨立董事 劉慧儀	具會計師執照，具有二十五年以上財務會計相關專業所需之工作經驗	本公司獨立董事於選任前二年及任職期間，皆符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」及證券交易法第十四條之二所訂資格要件，且獨立董事皆已依證券交易法第十四條之三賦予充分參與決策及表示意見之權利，據以獨立執行相關職權。(註1)	1
獨立董事 洪欣儒	具國內律師執照及美國紐約州律師資格，為執業律師具法務相關專業所需之工作經驗		1
獨立董事 胡瑞卿	具有二十五年以上半導體相關以及經營管理相關所需之工作經驗		1

註1：本公司 114.12.15 公開發行後，於 115.2.11 股東臨時會完成獨立董事選任。

## (五)董事會多元化及獨立性

### 1. 董事會多元化

本公司現任董事會共七席董事，其中包含三名獨立董事，董事成員具備產業、營運、財會、管理等領域之豐富經驗與專業，考量整體董事會成員背景的多元性（包含性別、年齡與文化）。目前本公司董事會成員來自不同產業及學術領域，涵蓋國內及歐美多國文化，並確保性別的平衡與公平等所組成。董事會成員多元化政策落實情形如下表：

董事會成員		國籍	性別		年齡	專業背景與產業能力						
職稱	姓名		男	女		產業經歷	經營管理	營運判斷	投資管理	風險管理	決策能力	領導能力
董事長	林斯穎	中華民國	✓		71~80 歲	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
董事	陳文冠	中華民國	✓		51~60 歲	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓
董事	林逸羣	中華民國	✓		51~60 歲	✓	-	✓	-	-	✓	✓
董事	張添昌	中華民國	✓		51~60 歲	✓	✓	✓	-	-	✓	✓
獨立董事	劉慧儀	中華民國		✓	41~50 歲	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
獨立董事	洪欣儒	中華民國		✓	41~50 歲	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
獨立董事	胡瑞卿	中華民國		✓	51~60 歲	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

### 2. 董事會獨立性

本公司董事共計四席，獨立董事共計三席，董事間無具有配偶及二親等以內親屬關係之情形，未來規劃設置獨立董事加強董事間獨立性，尚符合證券交易法第26條之3第3項規定之情事。

## (六)總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管

115年4月23日；單位：股；%

職稱	國籍	姓名	性別	選(就)任日期	持有股份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義持有股份		主要經(學)歷	目前兼任其他公司之職務	具配偶或二親等以內關係之經理人			備註
					股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率			職稱	姓名	關係	
總經理	中華民國	陳文冠	男	90.01.01	287,493	1.36%	-	-	-	-	●國立陽明交通大學 ●資訊工程學系	●瀚發貿易(上海)有限公司董事長 ●翌驊實業(股)公司董事 ●冠兆投資(股)公司董事長	-	-	-	-
事業二處資深副總經理	中華民國	林逸羣	男	111.08.01	733,125	3.47%	-	-	-	-	●美國曼菲斯大學商學院碩士 ●國立台灣大學大氣科學系 ●遠東紡織業務課長	-	-	-	-	
事業一處副總經理	中華民國	張睿政	男	111.07.01	611,710	2.90%	-	-	-	-	●東海大學物理系	-	-	-	-	
事業三處副總經理	中華民國	邱哲儀	男	108.09.01	218,200	1.03%	-	-	-	-	●國立嘉義大學農經系	-	-	-	-	
瀚發資深副總經理	中華民國	陳國烘	男	109.05.07	20,000	0.09%	14,000	0.07%	-	-	●中原大學土木工程學系碩士	-	稽核室協理(稽核長)	李倩倩	配偶	-
瀚發副總經理	中國大陸	黃崢春	男	109.5.01	-	-	-	-	-	-	●西北工業大學外語系	-	-	-	-	
資材處資深顧問	中華民國	桑友樂	男	111.08.01	87,544	0.41%	-	-	-	-	●國立成功大學 ●系統及船舶機電工程學系 ●國立成功大學工程科學所碩士 ●瀚軒(股)公司研發製造處 ●副總經理	-	-	-	-	

職稱	國籍	姓名	性別	選(就)任日期	持有股份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義持有股份		主要經(學)歷	目前兼任其他公司之職務	具配偶或二親等以內關係之經理人			備註
					股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率			職稱	姓名	關係	
管理處協理 (財務長)	中華民國	江美雲	女	109.07.01	79,095	0.37%	-	-	-	-	●嶺東商業專科學校企管系	-	-	-	-	-
稽核室協理 (稽核長)	中華民國	李倩倩	女	113.04.01	14,000	0.07%	20,000	0.09%	-	-	●世新大學新聞系	-	瀚發 資深 副總經理	陳國 烘	配偶	-
事業一處協理	中華民國	陳俊良	男	108.11.11	74,398	0.35%	-	-	-	-	●逢甲大學自動工程學系	-	-	-	-	-
總經理室協理	中華民國	呂致宏	男	109.07.01	10,000	0.05%	7,000	0.03%	-	-	●逢甲大學企管系	-	-	-	-	-
管理處財會部 資深經理 (會計主管 兼公司治理 主管)	中華民國	劉秀慧	女	114.08.18	-	-	-	-	-	-	●逢甲大學會計系 ●國立台灣大學 EMBA 學分班 ●亞源科技財務經理 ●毅嘉科技經營管理、稽核副理	-	-	-	-	-

(七)董事長與總經理或相當職務者(最高經理人)為同一人、互為配偶或一親等親屬者，應說明其原因、合理性、必要性及因應措施：無此情事。

## 二、最近年度給付董事、監察人、總經理及副總經理等之酬金

### (一)一般董事及獨立董事之酬金：

114年12月31日；單位：新臺幣仟元

職稱	姓名	董事酬金								A、B、C及D等 四項總額及占稅 後純益之比例		兼任員工領取相關酬金						A、B、C、D、E、F及 G等七項總額及占稅 後純益之比例		領取來自 子公司 以外 投資 酬金		
		報酬 (A)		退職退休金 (B)		董事酬勞 (C)		業務執行費用 (D)		薪資、獎金及特 支費等(E)		退職退休金 (F)		員工酬勞 (G)				本公司	財務報告 內所有公 司			
		本公司	財務報 告內所 有公司	本公司	財務報 告內所 有公司	本公司	財務報 告內所 有公司	本公司	財務報 告內所 有公司	本公司	財務報 告內所 有公司	本公司	財務報 告內所 有公司	本公司		財務報告內 所有公司						
董事長	林斯穎																					
董事	陳文冠																					
董事	林逸羣	-	-	-	-	2,000	2,000	35	35	2,035 2.18%	2,035 2.18%	26,372	29,848	-	-	3,862	-	3,862	-	32,269 34.57%	35,746 38.29%	-
董事	張睿政																					
董事	邱哲儀																					

1. 請敘明獨立董事酬金給付政策、制度、標準與結構，並依所擔負之職責、風險、投入時間等因素敘明與給付酬金數額之關聯性：本公司114年尚未設置獨立董事，故不適用。  
2. 除上表揭露外，最近年度公司董事為財務報告內所有公司提供服務(如擔任母公司/財務報告內所有公司/轉投資事業非屬員工之顧問等)領取之酬金：無。

酬金級距表

給付本公司各個董事酬金級距	董事姓名			
	前四項酬金總額(A+B+C+D)		前七項酬金總額(A+B+C+D+E+F+G)	
	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司
低於 1,000,000 元	陳文冠、林逸羣、張睿政、邱哲儀	陳文冠、林逸羣、張睿政、邱哲儀	-	-
1,000,000 元(含)~2,000,000 元(不含)	-	-	-	-
2,000,000 元(含)~3,500,000 元(不含)	林斯穎	林斯穎	林斯穎	林斯穎
3,500,000 元(含)~5,000,000 元(不含)	-	-	-	-
5,000,000 元(含)~10,000,000 元(不含)	-	-	林逸羣、張睿政、邱哲儀	林逸羣、張睿政、邱哲儀
10,000,000 元(含)~15,000,000 元(不含)	-	-	陳文冠	陳文冠
15,000,000 元(含)~30,000,000 元(不含)	-	-	-	-
30,000,000 元(含)~50,000,000 元(不含)	-	-	-	-
50,000,000 元(含)~100,000,000 元(不含)	-	-	-	-
100,000,000 元以上	-	-	-	-
總計	共 5 人	共 5 人	共 5 人	共 5 人

(二)監察人之酬金：

114年12月31日；單位：新臺幣仟元

職稱	姓名	監察人酬金						A、B及C等三項總額及 占稅後純益之比例		領取來自子公司 以外轉投資 事業酬金
		報酬(A)		酬勞(B)		業務執行費用(C)		本公司	財務報告內 所有公司	
		本公司	財務報告內 所有公司	本公司	財務報告內 所有公司	本公司	財務報告內 所有公司			
監察人	冠兆投資(股)公司	-	-	-	-	50	50	0.05	0.05	-
監察人	李復華	-	-	-	-	-	-	-	-	-

酬金級距表

給付本公司各個監察人酬金級距	監察人姓名	
	前四項酬金總額(A+B+C+D)	
	本公司	財務報告內所有公司
低於 1,000,000 元	冠兆投資(股)公司、李復華	
1,000,000 元(含)~2,000,000 元(不含)	-	-
2,000,000 元(含)~3,500,000 元(不含)	-	-
3,500,000 元(含)~5,000,000 元(不含)	-	-
5,000,000 元(含)~10,000,000 元(不含)	-	-
10,000,000 元(含)~15,000,000 元(不含)	-	-
15,000,000 元(含)~30,000,000 元(不含)	-	-
30,000,000 元(含)~50,000,000 元(不含)	-	-
50,000,000 元(含)~100,000,000 元(不含)	-	-
100,000,000 元以上	-	-
總計	共 2 人	共 2 人

(三)總經理及副總經理之酬金：

114年12月31日；單位：新臺幣仟元

職稱	姓名	薪資(A)		退職退休金(B)		獎金及特支費等(C)		員工酬勞金額(D)				A、B、C及D等四項總額及占稅後純益之比例		領取來自子公司以外轉投資事業酬金
		本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司		財務報告內所有公司		本公司	財務報告內所有公司	
								現金金額	股票金額	現金金額	股票金額			
總經理	陳文冠	11,109	18,460	-	-	16,633	22,599	3,987	-	3,987	-	31,729	45,047	-
資深副總	林逸羣													
副總經理	張睿政													
副總經理	邱哲儀													
瀚發副總	陳國烘													
瀚發副總	黃崢春													
												33.99%	48.26%	

酬金級距表

給付本公司各個總經理及副總經理酬金級距	總經理及副總經理姓名	
	本公司	財務報告內所有公司
低於 1,000,000 元	-	-
1,000,000 元(含)~2,000,000 元(不含)	-	-
2,000,000 元(含)~3,500,000 元(不含)	-	-
3,500,000 元(含)~5,000,000 元(不含)	-	-
5,000,000 元(含)~10,000,000 元(不含)	林逸羣、張睿政、邱哲儀、陳國烘、黃崢春	林逸羣、張睿政、邱哲儀、陳國烘、黃崢春
10,000,000 元(含)~15,000,000 元(不含)	-	-
15,000,000 元(含)~30,000,000 元(不含)	陳文冠	陳文冠
30,000,000 元(含)~50,000,000 元(不含)	-	-
50,000,000 元(含)~100,000,000 元(不含)	-	-
100,000,000 元以上	-	-
總計	共 6 人	共 6 人

(四)最近年度分派員工酬勞之經理人姓名及分派情形：

114年12月31日；單位：新臺幣仟元；%

類別	職稱	姓名	股票金額	現金金額	總計	總額占稅後純益之比例(%)
經理人	總經理	陳文冠	-	5,997	5,997	6.42%
	資深副總	林逸羣				
	副總經理	張睿政				
	副總經理	邱哲儀				
	瀚發副總	陳國烘				
	瀚發副總	黃崢春				
	資深顧問	桑友樂				
	協理	江美雲				
	協理	李倩倩				
	協理	陳俊良				
	協理	呂致宏				
	會計主管	劉秀慧				

(五)上市上櫃公司前五位酬金最高主管之酬金：不適用

(六)本公司及合併報表所有公司於最近二年度給付本公司董事、監察人、總經理及副總經理等之酬金總額占個體或個別財務報告稅後純益比例之分析：

單位：新臺幣仟元；%

職稱	113年度				114年度			
	酬金總額		占稅後純益比例		酬金總額		占稅後純益比例	
	本公司	合併報告所有公司	本公司	合併報告所有公司	本公司	合併報告所有公司	本公司	合併報告所有公司
董事	2,000	2,000	1.64%	1.64%	2,035	2,035	2.18%	2.18%
監察人	-	-	-	-	50	50	0.05%	0.05%
總經理及副總經理	38,230	52,905	31.27%	43.27%	31,729	45,047	33.99%	48.26%

(七)給付酬金之政策、標準與組合、訂定酬金之程序、與經營績效及未來風險之關聯性：

本公司給付董事、監察人酬勞均係依照公司章程辦理，酬勞分派應提股東會報告；而本公司支付總經理及副總經理之酬金，係考量其所擔任之職務及承擔之責任，當年度對公司營運目標達成之貢獻度，並參酌該職位於同業市場中之薪資水準訂定，而給予合理報酬。

### 三、公司治理運作情形

#### (一)董事會運作情形

當年度及最近年度董事會開會 9 次<sup>④</sup>，董事出席情形如下：

截至 115 年 4 月 23 日

職稱	姓名	實際出(列)席次數 <sup>⑤</sup>	委託出席次數	實際出(列)席率(%) ( <sup>⑥</sup> / <sup>④</sup> )	備註
董事長	林斯穎	9	0	100%	於 113/12/16 選任
董事	陳文冠	9	0	100%	於 113/12/16 選任
董事	林逸羣	9	0	100%	於 113/12/16 選任
董事	張睿政	6	0	100%	於 113/12/16 選任 於 115/2/11 改選後辭任 (應出席次數 6 次)
董事	邱哲儀	6	0	100%	於 113/12/16 選任 於 115/2/11 改選後辭任 (應出席次數 6 次)
董事	張添昌	2	1	66.67%	於 115/2/11 改選後選任 (應出席次數 3 次，其中 1 次委託出席)
獨立董事	劉慧儀	3	0	100%	於 115/2/11 改選後選任 選任(應出席次數 3 次)
獨立董事	洪欣儒	3	0	100%	於 115/2/11 改選後選任 (應出席次數 3 次)
獨立董事	胡瑞卿	3	0	100%	於 115/2/11 改選後選任 選任(應出席次數 3 次)
監察人	李復華	6	0	100%	本公司於 115/2/11 變更 章程，取消監察人改設審 計委員會(115 年度於 115/2/11 前應出席次數 6 次)
監察人	冠兆投資 (股)公司	5	0	83.33%	

其他應記載事項：

1. 董事會之運作如有下列情形之一者，應敘明董事會日期、期別、議案內容、所有獨立董事意見及公司對獨立董事意見之處理：

① 證交法第 14 條之 3 所列事項：無。

② 除前開事項外，其他經獨立董事反對或保留意見且有紀錄或書面聲明之董事會議決事項：無。

2. 董事對利害關係議案迴避之執行情形，應敘明董事姓名、議案內容、應利益迴避原因以及參與表決情形：

① 114.08.04 董事會擬簽訂桃園市中壢區普義段 46 號土地租約案，董事長林斯穎先生與林大為先生為一親等關係，因涉及個人事項迴避討論及表決。

② 114.12.26 董事會解除本公司員工兼任子公司職務競業禁止限制案，董事陳文冠因涉及個人事項迴避討論及表決。

- ③ 115.2.23 董事會委任第一屆審計委員會委員案，委任劉慧儀、洪欣儒、胡瑞卿等全體獨立董事 3 人擔任本公司第一屆審計委員，因董事酬勞之分配與自身利益相關，對該議案之討論及表決過程分別予以迴避。
- ④ 115.2.23 董事會委任第一屆薪酬委員會委員案，委任劉慧儀、洪欣儒、胡瑞卿等全體獨立董事 3 人擔任本公司第一屆薪酬委員，因董事酬勞之分配與自身利益相關，對該議案之討論及表決過程分別予以迴避。
- ⑤ 115.3.30 董事會審議本公司處長級以上主管薪資報酬政策與績效評估建議案，本案因兼任董事之經理人陳文冠、林逸羣因涉及個人事項，對該議案之討論及表決過程分別予以迴避。
- ⑥ 115.4.23 董事會本公司 115 年第 1 次現金增資，協理以上(含)員工可認購股數案，本案因兼任董事之經理人陳文冠、林逸羣因涉及個人事項，對該議案之討論及表決過程分別予以迴避。
- ⑦ 115.4.23 董事會本公司 114 年度員工酬勞(員工紅利)及其他獎金，協理以上(含)分配案，本案因兼任董事之經理人陳文冠、林逸羣因涉及個人事項，對該議案之討論及表決過程分別予以迴避。
- ⑧ 115.4.23 董事會本公司 114 年度董事酬勞分配案，董事長林斯穎因涉及個人事項迴避討論及表決。
3. 上市上櫃公司應揭露董事會自我(或同儕)評鑑之評估週期及期間、評估範圍、方式及評估內容等資訊，並填列附表二董事會評鑑執行情形：參閱下表董事會評鑑執行情形。
4. 當年度及最近年度加強董事會職能之目標(例如設立審計委員會、提升資訊透明度等)與執行情形評估：
- 114 年度：
- ① 提升資訊透明度：持續強化公司網站資訊揭露，以利利害關係人取得充分資訊。
  - ② 強化法令之遵循：持續檢視主管機關法令之修訂，更新並執行法令遵循。

董事會評鑑執行情形：

評估週期	評估期間	評估範圍	評估方式	評估內容
① 每年	114/1/1~114/12/31	整體董事會	董事會內部自評	對公司營運之參與程度、董事會決策品質、董事會組成與結構、董事的選任及持續進修、內部控制
② 每年	114/1/1~114/12/31	個別董事成員	董事自評	公司目標與任務之掌握、董事職責認知、對公司營運之參與程度、內部關係經營與溝通、董事之專業及持續進修、內部控制
③ 每年	114 年度尚未成立功能委員會(註)	功能性委員會(審計委員會、薪資報酬委員會)	不適用	不適用

註：本公司於 115 年 2 月 11 日股東臨時會決議通過依證券交易法第 14 條之 4 規定改由全體獨立董事

組成審計委員會以取代監察人，並將董事席次自 5 席增加至 7 席(含獨立董事 3 席)，本公司原任董事張睿政、邱哲儀及原任監察人李復華、冠兆投資股份有限公司為配合公司選任獨立董事以符合公司法、證交法及其他相關法令規定，於 115 年 2 月 11 日股東臨時會辭任董事及監察人職務，並於該次股東臨時會補選劉慧儀、洪欣儒、胡瑞卿等 3 席獨立董事及張添昌 1 席董事，並由全體獨立董事組成審計委員會以取代監察人，且審計委員會自獨立董事選任時成立，故該次股東臨時會不另行選任監察人。

## (二)審計委員會運作情形或監察人參與董事會運作情形

### 1. 審計委員會運作情形：

當年度及最近年度審計委員會開會 2 次<sup>①</sup>，獨立董事出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數 <sup>②</sup>	委託出席次數	實際出席率(%) ( <sup>②</sup> / <sup>④</sup> )	備註
獨立董事	劉慧儀	2	0	100%	於 115/2/11 改選後委任(應出席次數 2 次)
獨立董事	洪欣儒	2	0	100%	於 115/2/11 改選後委任(應出席次數 2 次)
獨立董事	胡瑞卿	2	0	100%	於 115/2/11 改選後委任(應出席次數 2 次)

其他應記載事項：

- 審計委員會之運作如有下列情形之一者，應敘明審計委員會召開日期、期別、議案內容、獨立董事反對意見、保留意見或重大建議項目內容、審計委員會決議結果以及公司對審計委員會意見之處理：
  - ① 證券交易法第 14 條之 5 所列事項：無此情事。
  - ② 除前開事項外，其他未經審計委員會通過，而經全體董事三分之二以上同意之議決事項：無此情事。
- 獨立董事對利害關係議案迴避之執行情形，應敘明獨立董事姓名、議案內容、應利益迴避原因以及參與表決情形：無此情事。
- 獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形（應包括就公司財務、業務狀況進行溝通之重大事項、方式及結果等）：
  - ① 稽核主管每月向獨立董事呈送稽核報告，並於董事會議向董事報告稽核執行狀況。
  - ② 稽核主管列席公司定期性董事會並作稽核業務報告，獨立董事並無反對意見。
  - ③ 獨立董事視實際情況以書面、電子通訊及會議方式與會計師進行財務狀況溝通。

### 2. 監察人參與董事會運作情形：

當年度及最近年度監察人開會 6 次<sup>①</sup>，監察人出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數 <sup>②</sup>	委託出席次數	實際出席率(%) ( <sup>②</sup> / <sup>④</sup> )	備註
監察人	李復華	6	0	100%	於 113/12/16 選任 於 115/2/11 改選後辭任(應出席次數 6 次)
監察人	冠兆投資(股)公司	5	0	83.33%	於 113/12/16 選任 於 115/2/11 改選後辭任(應出席次數 6 次)

其他應記載事項：

1. 監察人之組成及職責：

① 監察人與公司員工及股東之溝通情形（應包含溝通管道及方式等）：

- 監察人已出席董事會，若董事有反應員工之意見，會協助溝通。
- 監察人已出席股東會，若股東有意見，監察人亦會協助溝通。

② 監察人與內部稽核主管及會計師之溝通情形（應包括就公司財務、業務狀況進行溝通之重大事項、方式及結果等）：

- 稽核主管定期向監察人呈送稽核報告，並於董事會議向董事報告稽核執行狀況。
- 稽核主管列席公司定期性董事會並作稽核業務報告，監察人並無反對意見。
- 監察人視實際情況以書面、電子通訊及會議方式與會計師進行財務狀況溝通。

2. 監察人列席董事會如有陳述意見，應敘明董事會日期、期別、議案內容、董事會決議結果以及公司對監察人陳述意見之處理情形：無此情事。

(三) 公司治理運作情形及與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因

評估項目	運作情形		與上市上櫃 公司治理實 務守則差異 情形及原因	
	是	否		摘要說明
1. 公司是否依據「上市上櫃公司治理實務守則」訂定並揭露公司治理實務守則？	✓		1. 本公司已於114年12月26日董事會通過訂定「公司治理守則」，有關本公司公司治理實務守則，請至本公司官網/投資人關係/公司治理/內部規章查詢。	無重大差異
2. 公司股權結構及股東權益 ① 公司是否訂定內部作業程序處理股東建議、疑義、糾紛及訴訟事宜，並依程序實施？ ② 公司是否掌握實際控制公司之主要股東及主要股東之最終控制者名單？ ③ 公司是否建立、執行與關係企業間之風險控管及防火牆機制？ ④ 公司是否訂定內部規範，禁止公司內部人利用市場上未公開資訊買賣有價證券？	✓ ✓ ✓ ✓		2. 公司股權結構及股東權益 ① 本公司設有發言人及代理發言人機制，以負責處理股東建議、疑義、糾紛及訴訟事宜。 ② 本公司股務代理機構定期提供股東名簿及相關報表，並透過內部人申報制度了解公司之主要股東及主要股東之最終控制者名單之變化。 ③ 本公司訂有與關係人往來之規範，相關作業需按章執行，以落實風險控管。 ④ 本公司平時即加強內部人法令遵循之宣導，使其了解相關規定並遵守。	無重大差異
3. 董事會之組成及職責 ① 董事會是否擬訂多元化政策、具體管理目標及落實執行？ ② 公司除依法設置薪資報酬委員會及審計委員會外，是否自願設置其他各類功能性委員會？	✓ ✓		3. 董事會之組成及職責 ① 本公司現任董事會共七席董事，其中包含三名獨立董事，董事成員具備產業、營運、財會、管理等領域之豐富經驗與專業，考量整體董事會成員背景的多元性(包含性別、年齡與文化)。目前本公司董事會成員來自不同產業及學術領域，涵蓋國內及歐美多國文化，並確保性別的平衡與公平等所組成，整體而言，本公司已積極朝多元化目標前進，並落實執行。 ② 本公司目前尚無自願設置其他各類功能性委員會。	無重大差異

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
③ 公司是否訂定董事會績效評估辦法及其評估方式，每年並定期進行績效評估，且將績效評估之結果提報董事會，並運用於個別董事薪資報酬及提名續任之參考？  ④ 公司是否定期評估簽證會計師獨立性？	✓		③ 本公司已於 114 年 12 月 26 日董事會訂定董事會績效評估辦法及其評估方式，辦法中明訂將個別董事績效評估結果作為遴選之參考依據；每年執行一次內部董事會績效評估，已於 115 年 3 月份完成 114 年度董事會、董事成員績效評估，並提報 114 年 3 月 30 日董事會報告，其評估結果： ① 董事會績效自評整體分數為 4.48 分（滿分 5 分）。 ② 董事成員績效自評整體平均分數為 4.82 分（滿分 5 分）。 ④ 本公司每年定期評估簽證會計師獨立性，並送 115 年 3 月 30 日董事會決議，並要求簽證會計師參與列席董事會，以適時了解會計師及會計師事務所之現況，以符合獨立性之要求。	
4. 上市上櫃公司是否配置適任及適當人數之公司治理人員，並指定公司治理主管，負責公司治理相關事務（包括但不限於提供董事、監察人執行業務所需資料、協助董事、監察人遵循法令、依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜、製作董事會及股東會議事錄等）？		✓	4. 本公司於 114 年 12 月 15 日公開發行，尚未上市櫃，將於上市櫃前依照規定設置公司治理主管，負責公司治理相關事務。	不適用
5. 公司是否建立與利害關係人（包括但不限於股東、員工、客戶及供應商等）溝通管道，及於公司網站設置利害關係人專區，並妥適回應利害關係人所關切之重要企業社會責任議題？	✓		5. 本公司已設有發言人及代理發言人，作為公司與對外利害關係人溝通之管道，並於公司網站設置投資人專區/利害關係人專區進行溝通。	無重大差異
6. 公司是否委任專業股務代辦機構辦理股東會事務？	✓		6. 本公司已委託華南永昌證券股務代理部作為本公司股務代辦機構辦理股東會事務。	無重大差異
7. 資訊公開 ① 公司是否架設網站，揭露財務業務及公司治理資訊？  ② 公司是否採行其他資訊揭露之方式（如架設英文網站、指定專人負責公司資訊之蒐集及揭露、落實發言人制度、法人說明會過程放置公司網站等）？  ③ 公司是否於會計年度終了後兩個月內公告並申報年度財務報告，及於規定期限前提早公告並申報第一、二、三季財務報告與各月份營運情形？	✓	✓	7. 資訊公開 ① 本公司已架設中英文網站，建置公司財務、業務相關資訊，並有專人負責維護，所列資料均詳實、正確並即時更新。 本公司網址：www.hpc.com.tw。 ② 本公司其他資訊公開之揭露方式如下： ① 架設英文版公司網站。 ② 指定專責人員負責公司資訊之蒐集及揭露。 ③ 統一由發言人代表公司對外發言，以確保可能影響股東及利害關係人決策之資訊，能夠及時充分揭露。 ③ 目前本公司均於法令規定期限前，完成公告並申報年度財務報告、第二季財務報告與各月份營運情形。	無重大差異
8. 公司是否有其他有助於瞭解公司治理運作情形之重要資訊（包括但不限於員工權益、僱員關懷、投資者關係、供應商關	✓		8. 有助於瞭解本公司公司治理運作情形之重要資訊： ① 員工權益： ① 嚴格要求性別平等，並屏除任何形式之歧視行為。	無重大差異

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司 治理實務守則差異 情形及原因
	是	否	
係、利害關係人之權利、董事及監察人進修之情形、風險管理政策及風險衡量標準之執行情形、客戶政策之執行情形、公司為董事及監察人購買責任保險之情形等)？			<p>② 透過勞資會議加強勞雇關係，並保障勞工權益。</p> <p>③ 提供暢通之申訴管道。</p> <p>④ 提供安全之就業環境，並宣導職災、環境安全等觀念。</p> <p>⑤ 提供外訓課程，使員工能提升自我專業能力。</p> <p>② 僱員關懷：</p> <p>① 成立職工福利委員會，提供僱員之婚、喪、病及生育之各項補助。</p> <p>② 依法提撥勞工退休金，以照顧僱員退休後之生活。</p> <p>③ 依法辦理勞工保險及全民健康保險。</p> <p>④ 定期提供僱員健康檢查服務。</p> <p>③ 投資者關係：</p> <p>① 資訊揭露原則： 屏除任何資訊不對稱之行為，以保護小股東之權益。</p> <p>② 落實發言人制度： 公平對待所有股東，對股東之詢問，皆竭盡回覆。</p> <p>③ 依法提供股東提案權： 依法公告股東會提案之相關資訊。</p> <p>④ 供應商關係： 本公司與供應商之間，均依據契約及相關作業規定履行權利義務，以維護雙方之合法權益。</p> <p>⑤ 利害關係人之權利：</p> <p>① 本公司於公司網站設置利害關係人專區。</p> <p>② 對於往來銀行及其他債權人，提供充足之資訊。</p> <p>⑥ 董事及監察人進修之情形： 本公司依法安排董事、監察人進修，並將內容公告於公開資訊觀測站。</p> <p>⑦ 風險管理政策及風險衡量標準之執行情形： 以公司內控制度為基礎，辨認公司風險，並執行高風險作業之稽核，並將結果提報於董事會。</p> <p>⑧ 客戶政策之執行情形： 本公司與客戶維持穩定良好關係，透過代理多項國際知名品牌之半導體設備與材料產品，並結合自有設備產品，提供客戶完整之製程整合服務。</p> <p>⑨ 公司為董事及經理人購買責任保險之情形： 公司每年定期購買相關保險。</p>
<p>9. 請就台灣證券交易所股份有限公司公司治理中心最近年度發布之公司治理評鑑結果說明已改善情形，及就尚未改善者提出優先加強事項與措施：(未列入受評公司者無須填列)</p> <p>無</p>			

(四)薪資報酬委員會組成及運作情形

1. 薪資報酬委員會成員資料：

截至 115 年 4 月 23 日

身份別	姓名	條件	專業資格與經驗	獨立性情形	兼任其他 公開發行 公司薪資 報酬委員 會成員家 數
獨立董事 (召集人)	胡瑞卿		具備企業經營管理、投資規劃專長(史丹佛大學運籌管理系碩士)、擔任過漢民科技(股)公司策略投資副總經理、漢民科技(股)公司及漢民微測科技(股)公司等新事業發展副總經理等職務。 未有公司法第 30 條各款情事之一。	符合公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法第三條第一項 1~9 款之獨立性規範及股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法第六條第一項 1~9 款之獨立性規範 符合公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法第二條第二項之規範 持有公司股份：0 股	1
獨立董事	劉慧儀		具會計師執照，具備會計及財務專長(台灣大學商學系畢業)、擔任過台亞風能(股)公司營運管理總監、證券櫃檯買賣中心上櫃審查部專員等職務。 未有公司法第 30 條各款情事之一。	符合公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法第三條第一項 1~9 款之獨立性規範及股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法第六條第一項 1~9 款之獨立性規範 符合公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法第二條第二項之規範 持有公司股份：0 股	1
獨立董事	洪欣儒		具國內律師執照及美國紐約州律師資格(美國紐約大學法律系 LLM、台灣大學法律系)、擔任過台理法律事務所資深律師、目前為緯鴻眾理法律事務所主持律師具法務相關專業所需之工作經驗。 未有公司法第 30 條各款情事之一。	符合公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法第三條第一項 1~9 款之獨立性規範及股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法第六條第一項 1~9 款之獨立性規範 符合公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法第二條第二項之規範 持有公司股份：0 股	1

2. 薪資報酬委員會運作情形資訊：

(1)本公司之薪資報酬委員會委員計 3 人。

(2)本屆委員任期：115 年 2 月 11 日至 116 年 12 月 15 日，當年度及最近年度薪資報酬委員會開會 2 次<sup>①</sup>，委員資格及出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席 次數 <sup>①</sup>	委託出席 次數	實際出席率 ( <sup>②</sup> / <sup>①</sup> )	備註
召集人	胡瑞卿	2	0	100%	於 115/2/23 董事會委任(應出席次數 2 次)
委員	劉慧儀	2	0	100%	於 115/2/23 董事會委任(應出席次數 2 次)
委員	洪欣儒	2	0	100%	於 115/2/23 董事會委任(應出席次數 2 次)

其他應記載事項：

① 董事會如不採納或修正薪資報酬委員會之建議，應敘明董事會日期、期別、議案內容、董事會決議結果以及公司對薪資報酬委員會意見之處理(如董事會通過之薪資報酬優於薪資報酬委員會之建議，應敘明其差異情形及原因)：無此情事。

② 薪資報酬委員會之議決事項，如成員有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明者，應敘明薪資報酬委員會日期、期別、議案內容、所有成員意見及對成員意見之處理：無此情事。

3. 提名委員會成員資料及運作情形資訊：不適用。

(五) 推動永續發展執行情形及與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因

推動項目	執行情形		與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	
1. 公司是否建立推動永續發展之治理架構，且設置推動永續發展專(兼)職單位，並由董事會授權高階管理階層處理，及董事會督導情形？	✓	本公司目前依相關法規尚無需設置專責或兼任之永續發展推動單位，惟已訂定辦法並由各相關部門依其職責分工推動相關事項，並規劃逐步建立永續發展專責組織，以強化整體治理與推動效能。 CZ-127 永續發展實務守則	不適用
2. 公司是否依重大性原則，進行與公司營運相關之環境、社會及公司治理議題之風險評估，並訂定相關風險管理政策或策略？	✓	本公司目前依相關法規尚無需設置專責或兼任之永續發展推動單位，惟已訂定辦法並由各相關部門依其職責分工推動相關事項，未來依需求之規範要求將進行環境考量面與危害鑑別風險評估、組織內外部議題及相關利害相關者需求與期望評估，以達危害認知、風險控制、污染預防目標。	不適用
3. 環境議題 (1) 公司是否依其產業特性建立合適之環境管理制度？	✓	本公司產品組裝所需零組件，均委外製作，無任何環境污染問題；且本公司已訂訂『安全衛生工作守則』，積極進行環境、安全、衛生方面之自主管理，以確保員工工作環境之安全衛生，維護生態平衡。	不適用
(2) 公司是否致力於提升能源使用效率及使用對環境負荷衝擊低之再生物料？	✓	1. 本公司持續提升能源使用效率，包括無紙化、節電、生活垃圾減量回收等。 2. 公司不使用免洗餐具，減少垃圾袋的使用，鼓勵紙張雙面使用並回收。	不適用
(3) 公司是否評估氣候變遷對企業現在及未來的潛在風險與機會，並採取相關之因應措施？	✓	將溫室氣體減量議題納入風險管理程序，持續評估氣候變遷對公司的潛在風險與機會，並積極推動節能減碳、減少用水與其他廢棄物管理計畫。	不適用
(4) 公司是否統計過去兩年溫室氣體排放量、用水量及廢棄物總重量，並制定溫室氣體減量、減少用水或其他廢棄物管理之政策？	✓	本公司主要業務為代理買賣、研發設計組裝測試介面及半導體設備，所需零組件均委外生產，故用水量不高且廢棄物也不多。對於節能減碳與溫室氣體減量策略說明如下： 1. 降低能源使用量、提昇效率：選用節能減碳產品如 LED 照明，檢查關閉不必要的電源等。 2. 落實回收減少廢棄物措施：不使用回收餐具以持續進行減少廢棄物，做好垃圾分類已提高可回收廢棄物資源等。 公司未來將依規定每年定期統計溫室氣體排放量、用水量及廢棄物總重量，依營運活動之影響，制定公司節能減碳策略，及推動各項節能措施，如隨手關燈及無紙化作業、廢棄物減量、資源分類回收等活動，以降低公司營運對自然環境之衝擊。	不適用
4. 社會議題 (1) 公司是否依照相關法規及國際人權公約，制定相關之管理政策與程序？	✓	公司依法訂定工作規則，並公開揭示同仁週知，其中規範員工的各項權益，如休假、考勤、退休、職災、性騷擾防治、福利與安全衛生等。人權管理政策及具體方案摘要如下： 1. 提供安全與健康的工作環境。 2. 協助員工維持身心健康及工作生活平衡：中午休息 1 小時，給予同仁充足午休時間。 3. 禁止強迫勞動、恪遵當地政府勞動法令：落實休假制度，鼓勵同仁注重工作與生活平衡。	不適用
(2) 公司是否訂定及實施合理員工福利措施(包括薪酬、	✓	公司薪酬係參考相關業界訂定，休假則完全依法令辦理。如有獲利，則依照章程提撥並發放員工酬勞。	不適用

推動項目	執行情形		與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	
休假及其他福利等),並將經營績效或成果適當反映於員工薪酬?			依本公司章程所載員工分紅之成數為本公司年度如有獲利,應依辦法視實際業務盈餘狀況,核發獎金紅利作為員工績效獎金及員工分紅。其休假及其他福利均依循勞基法為遵循基準。 CW-003-01 員工薪資管理辦法
(3)公司是否提供員工安全與健康之工作環境,並對員工定期實施安全與健康教育?	✓		本公司遵循 ISO 要求,以提供安全衛生的工作環境為目標,致力於消除危害及降低職安衛風險,創造良好的工作職場;並定期對員工施行職安衛教育訓練及辦理宣導活動,以提昇員工危害認知、風險控制、污染預防及緊急應變能力。並每兩年實施員工健康檢查,確保員工安全健康。
(4)公司是否為員工建立有效之職涯能力發展培訓計畫?	✓		本公司為使員工具備專業素養與發展優勢,不定期舉辦內部訓練課程及派外接受專業訓練。藉此提升員工專業能力,實踐員工職涯發展目標,進而達成企業營運目標。 2026 年度訓練計畫表
(5)針對產品與服務之顧客健康與安全、客戶隱私、行銷及標示等議題,公司是否遵循相關法規及國際準則,並制定相關保護消費者或客戶權益政策及申訴程序?	✓		1. 本公司針對產品與服務之顧客健康與安全、客戶隱私、行銷及標示等議題,均依相關法令及產業規範辦理,並納入內部控制制度及品質管理系統執行。 2. 本公司已通過 ISO 9001 品質管理系統認證,透過制度化流程、風險控管及持續改善機制,確保產品與服務品質及客戶權益。 3. 客戶隱私方面,除依個人資料保護法建置相關管理規範,並於訂單、合約或另訂保密協議,並落實資料存取控管與資訊安全措施。 4. 本公司建立客戶申訴與回饋機制,由專責窗口受理並追蹤處理結果,並定期檢討改善。 5. 未來將配合公司永續發展及上市櫃規劃,持續強化客戶權益保障制度與申訴處理流程,提升管理透明度與服務品質。 6. 本公司定期執行內部稽核與管理審查,以確保制度有效運作。
(6)公司是否訂定供應商管理政策,要求供應商在環保、職業安全衛生或勞動人權等議題遵循相關規範,及其實施情形?	✓		1. 本公司已訂有供應商管理相關規範,並透過供應商評選及定期評核機制,進行供應商之管理與監督。 2. 在供應商管理過程中,計畫未來將環境保護、職業安全衛生及勞動人權等 ESG 議題納入評估項目,並要求供應商遵循相關法令及基本企業責任原則。 3. 目前相關作業係結合採購流程及品質管理制度 (ISO 9001) 執行,以確保供應鏈品質、交期及合規性。 4. 未來將依公司永續發展策略,逐步建置供應商永續管理制度,包含供應商行為準則、風險評估及稽核機制,以強化供應鏈管理之深度與廣度。
5. 公司是否參考國際通用之報告書編製準則或指引,編製永續報告書等揭露公司非財務資訊之報告書?前揭報告書是否取得第三方驗證單位之確信或保證意見?		✓	本公司將依規定時間於上櫃後參考國際通用報告書編製準則出具永續報告書,內文中揭露公司非財務資訊,最終將報告書放置公司網站上供參閱,因尚未編製,故目前亦未請第三方驗證。
6. 公司如依據「上市上櫃公司永續發展實務守則」定有本身之永續發展守則者,請敘明其運作與所定守則之差異情形:本公司永續發展守則依據「上市上櫃公司永續發展實務守則」訂定,並經董事會通過,經依法令規定時程依循守則辦理相關作業。			
7. 其他有助於瞭解推動永續發展執行情形之重要資訊: 本公司訊息之發布以即時且透明為原則,且關於永續發展相關資訊完整揭露於年報中。			

(六)上市上櫃公司氣候相關資訊:不適用。

(七)履行誠信經營情形及與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因	
	是	否		摘要說明
<p>1. 訂定誠信經營政策及方案</p> <p>(1)公司是否制定經董事會通過之誠信經營政策，並於規章及對外文件中明示誠信經營之政策、作法，以及董事會與高階管理階層積極落實經營政策之承諾？</p> <p>(2)公司是否建立不誠信行為風險之評估機制，定期分析及評估營業範圍內具較高不誠信行為風險之營業活動，並據以訂定防範不誠信行為方案，且至少涵蓋「上市上櫃公司誠實經營守則」第七條第二項各款行為之防範措施？</p> <p>(3)公司是否於防範不誠信行為方案內明定作業程序、行為指南、違規之懲戒及申訴制度，且落實執行，並定期檢討修正前揭方案？</p>	<p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p>		<p>1. 訂定誠信經營政策及方案</p> <p>(1)本公司訂有「誠實經營守則」並依法令修訂同步更新，指定總經理室及管理處為專責單位，以落實董事會與管理階層相關指令。</p> <p>(2)相關作業依本公司「誠實經營守則」執行，並由稽核室進行查核。</p> <p>(3)相關作業依本公司「誠實經營守則」執行，並由稽核室進行查核。</p>	符合上市上櫃公司誠信經營守則
<p>2. 落實誠信經營</p> <p>(1)公司是否評估往來對象之誠信紀錄，並於其與往來交易對象簽訂之契約中明定誠信行為條款？</p> <p>(2)公司是否設置隸屬董事會之推動企業誠信經營專責單位，並定期(至少一年一次)向董事會報告其誠信經營政策與防範不誠信行為方案及監督執行情形？</p> <p>(3)公司是否制定防止利益衝突政策、提供適當陳述管道，並落實執行？</p> <p>(4)公司是否為落實誠信經營已建立有效的會計制度、內部控制制度，並由內部稽核單位依不誠信行為風險之評估結果，擬訂相關稽核計畫，並據以查核防範不誠信行為方案之遵循情形，或委託會計師執行查核？</p> <p>(5)公司是否定期舉辦誠信經營之內、外部之教育訓練？</p>	<p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p>		<p>2. 落實誠信經營</p> <p>(1)本公司「誠實經營守則」規定本公司人員於從事商業行為過程中，應向交易對象說明公司之誠信經營政策與相關規定，並明確拒絕直接或間接提供、承諾、要求或收受任何形式或名義之不正當利益。並與部分往來對象簽訂契約時，充分瞭解對方之誠信經營狀況，但尚未於往來交易對象簽訂之契約中明訂誠信行為條款。</p> <p>(2)本公司「誠實經營守則」明訂本公司由總經理室及管理處負責誠信經營政策與防範方案之制定與推動，已納入稽核計畫，未來將由內部稽核人員負責監督執行，並作成稽核報告提報董事會。</p> <p>(3)本公司訂有「誠實經營守則」與「道德行為準則」明訂全體員工遵守以避免員工因個人利益而犧牲公司權益。</p> <p>(4)本公司已建立有效之會計制度及內部控制制度，本公司內部稽核人員已排定稽核計畫，並執行查核前項制度遵行情形。</p> <p>(5)本公司於定期主管會議及部門內部會議宣導誠信經營相關事項。</p>	符合上市上櫃公司誠信經營守則
<p>3. 公司檢舉制度之運作情形</p> <p>(1)公司是否訂定具體檢舉及獎勵制度，並建立便利檢舉管道，及針對被檢舉對象指派適當之受理專責人員？</p> <p>(2)公司是否訂定受理檢舉事項之調查標準作業程序、調查完成後應採取之後續措施及相關保密機制？</p> <p>(3)公司是否採取保護檢舉人不因檢舉而遭受不當處置之措施？</p>	<p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p>		<p>3. 公司檢舉制度之運作情形</p> <p>(1)相關作業依本公司「誠實經營守則」執行，並由稽核室進行查核。</p> <p>(2)相關作業依本公司「誠實經營守則」執行，並由稽核室進行查核。</p> <p>(3)相關作業依本公司「誠實經營守則」執行，並由稽核室進行查核。</p>	符合上市上櫃公司誠信經營守則
<p>4. 加強資訊揭露</p> <p>公司是否於其網站及公開資訊觀測站，揭露</p>	<p>✓</p>		<p>4. 加強資訊揭露</p> <p>本公司訊息之發布以即時且透明為原則於</p>	不適用

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	
其所定誠信經營守則內容及推動成效？			公開資訊觀測站揭露，有關於誠實經營相關資訊，未來上市櫃後將依規定執行。
5. 公司如依據「上市上櫃公司誠信經營守則」定有本身之誠信經營守則者，請敘明其運作與所定守則之差異情形：目前運作尚無重大差異。			
6. 其他有助於瞭解公司誠信經營運作情形之重要資訊：（如公司檢討修正其訂定之誠實經營守則等情形） 本公司於114/12/26董事會通過依「上市上櫃公司誠信經營守則」訂定本公司「誠實經營守則」並依法於股東會報告。			

(八)其他足以增進對公司治理運作情形瞭解之重要資訊

本公司董事不定期參加公司治理相關課程訓練如下：

身份	姓名	進修日期	主辦單位	課程名稱	進修時數	進修是否符合規定
董事長	林斯穎	115/4/23	協合國際法律事務所	公司治理與證券法規	3	是
董事	陳文冠	115/4/23	協合國際法律事務所	公司治理與證券法規	3	是
董事	林逸羣	115/4/23	協合國際法律事務所	公司治理與證券法規	3	是
獨立董事	劉慧儀	115/4/23	協合國際法律事務所	公司治理與證券法規	3	是
獨立董事	洪欣儒	115/4/23	協合國際法律事務所	公司治理與證券法規	3	是
獨立董事	胡瑞卿	115/4/23	協合國際法律事務所	公司治理與證券法規	3	是

(九)內部控制制度執行狀況

1. 內部控制聲明書

請參閱本公司於公開資訊觀測站（新版MOPS）之公告申報，

索引路徑：公開資訊觀測站>單一公司>公司治理>公司規章/內部控制>內控聲明書公告。

網址：<https://mops.twse.com.tw/mops/#/web/t06sg20>

2. 委託會計師專案審查內部控制制度者，應揭露會計師審查報告：無

(十)最近年度及截至年報刊印日止，股東會及董事會之重要決議

股東會/董事會	日期	重要決議
董事會	114/4/22	1. 本公司會計原則轉換案。 2. 本公司「提升自行編製財務報告能力計畫書」案。 3. 本公司「自行編製財務報告能力計畫執行情形」案。 4. 本公司申請股票公開發行及興櫃掛牌案。 5. 訂定本公司「董事會議事規則」案。 6. 訂定本公司113年度員工酬勞及董監事酬勞分派案。 7. 113年度營業報告書及財務報表案。

股東會/董事會	日期	重要決議
		8. 113 年度盈餘分配案。 9. 盈餘轉增資發行新股案。 10. 本公司基層員工定義案。 11. 修正「公司章程」部份條文案。 12. 114 年股東常會召開事宜。
股東會	114/6/30	1. 重編 112 年度財務報表案。 2. 113 年度營業報告書及財務報表案。 3. 113 年度盈餘分配案。 4. 訂定本公司「董事會議事規則」。 5. 員工酬勞及董事酬勞分派案。 6. 修正「公司章程」部份條文案。 7. 盈餘轉增資發行新股案。
董事會	114/07/04	1. 訂定本公司分配 113 年度盈餘之除息基準日、除權基準日、現金股利發放日及相關事宜案。 2. 本公司擬發行 114 年度第 1 次員工認股權憑證相關事宜案。
董事會	114/08/04	1. 本公司擬簽訂桃園市中壢區普義段 46 號土地租約案。 2. 本公司與兆豐商業銀行之綜合授信契約申請追認案。
董事會	114/09/08	1. 訂定本公司 114 年度第 1 次員工認股權憑證認購之發行普通股新股基準日案。
董事會	114/11/17	1. 本公司申請股票公開發行及興櫃掛牌案。 2. 配合會計師事務所內部調整，變更簽證會計師案。 3. 本公司辦理首次公開發行之 113 年 7 月 1 日至 114 年 6 月 30 日之內部控制制度聲明書案。 4. 為配合土地租賃契約，擬調整桃園市中壢區不動產廠房資產耐用年限估計值案。 5. 本公司 114 年第二季財務報表案。 6. 指定本公司背書保證及經濟部印鑑章保管人案。 7. 指定本公司銀行印鑑保管人案。 8. 修正本公司組織圖。 9. 本公司財務主管、會計主管、研發主管、發言人、代理發言人任命案。
董事會	114/12/26	1. 本公司 115 年度預算案。 2. 本公司 115 年度營運計劃案。 3. 訂定本公司「關係人相互間財務業務相關作業規範」案。 4. 訂定本公司「內部重大資訊處理作業」等管理辦法案。 5. 修訂「公司章程」部份條文案。 6. 修訂「股東會議事規則」部份條文案。 7. 修訂「董事會議事規則」部份條文案。 8. 修訂「董事及監察人選任程序」部份條文並更名為「董事選任程序」案。 9. 修訂「取得或處分資產處理程序」、「資金貸與他人作業程序」、「背書保證作業程序」部份條文案。 10. 依章程規定董事 5-7 席，因應本公司 2 席董事辭任擬補選 3 席獨立董事及 1 席董事暨成立審計委員會取代監察人案。 11. 本公司 115 年度稽核計畫。 12. 受理 115 年度第一次股東臨時會董事暨獨立董事提名期間及受理處所及本公司提名名單。

股東會/董事會	日期	重要決議
		13. 解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 14. 解除本公司員工兼任子公司職務競業禁止限制案。 15. 召集本公司 115 年第一次股東臨時會相關事宜。
股東臨時會	115/2/11	1. 訂定本公司「道德行為準則」案。 2. 訂定本公司「誠實經營守則」。 3. 訂定本公司「永續發展實務守則」案。 4. 修訂「董事會議事規則」部份條文案。 5. 調整桃園市中壢區不動產廠房資產耐用年限會計估計值案。 6. 修訂本公司「公司章程」案。 7. 修訂「股東會議事規則」部份條文案。 8. 修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案。 9. 修訂「資金貸與他人作業程序」部份條文案。 10. 修訂「背書保證作業程序」部份條文案。 11. 修訂「董事及監察人選任程序」部分條文並更名為「董事選任程序」案。 12. 依章程規定董事設置 5-7 席，因應本公司 2 席董事辭職，擬補選 3 席獨立董事及 1 席董事案。 13. 解除新任董事競業禁止之限制案。
董事會	115/2/23	1. 委任第一屆審計委員會委員案。 2. 委任第一屆薪酬委員會委員案。 3. 本公司擬申請上櫃案。 4. 本公司初次上櫃發行新股公開承銷，擬以現金增資發行新股辦理公開承銷，原股東放棄現金增資優先認股之權利案。 5. 召集本公司 115 年股東常會相關事宜。
董事會	115/3/30	1. 訂定本公司 114 年度員工酬勞及董監事酬勞分派案。 2. 114 年度營業報告書及財務報表案。 3. 本公司定期評估聘任會計師之獨立性及適任性。 4. 民國 115 年度財務報告簽證會計師委任及報酬案。 5. 本公司 114 年度「內部控制制度」設計及執行均有效聲明書。 6. 114 年度盈餘分配案。 7. 審議本公司處長級以上主管薪資報酬政策與績效評估建議案。 8. 修訂本公司「生產循環」等內控制度案。 9. 本公司基層員工定義年度評估案。 10. 修改稽核管理辦法。 11. 修改 115 年度稽核計劃案。 12. 本公司擬辦理現金增資發行新股案。
董事會	115/4/23	1. 本公司與兆豐銀行之綜合授信契約續約申請案。 2. 本公司 115 年第 1 次現金增資，經理人及協理以上（含）員工可認購股數案。 3. 本公司辦理現金增資發行新股案。 4. 本公司 114 年度員工酬勞（員工紅利）及其他獎金，經理人及協理以上（含）分配案。 5. 本公司 114 年度董事酬勞分配案。 6. 修訂本公司「核決權限表」案。

(十一)最近年度及截至年報刊印日止，董事或監察人對董事會通過重要決議有不同意見且有紀錄或書面聲明者，其主要內容：無

#### 四、簽證會計師公費資訊

##### (一)簽證會計師公費資訊

單位：新臺幣仟元

會計師事務所名稱	會計師姓名	會計師查核期間	審計公費	非審計公費	合計	備註
日正聯合會計師事務所	陳依玲	114.01.01	948	1,092	2,040	非審計公費服務內容為 IFRS 輔導費、工商服務費、公發前規劃費、稅務諮詢及其他服務費。
	陳燦煌	~ 114.12.31				

(二)更換會計師事務所且更換年度所給付之審計公費較更換前一年度之審計公費減少者：無

(三)審計公費較前一年度減少達百分之十以上者：無

#### 五、更換會計師資訊

- (一)關於前任會計師：不適用
- (二)關於繼任會計師：不適用
- (三)前任會計師之復函：不適用

#### 六、公司之董事長、總經理、負責財務或會計事務之經理人，最近一年內曾任職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業

無。

#### 七、最近年度及截至年報刊印日止董事、監察人、經理人及持股比例超過百分之十之股東股權移轉及股權質押變動情形

##### (一)股權變動情形：

請參閱本公司於公開資訊觀測站（新版MOPS）之公告申報，  
索引路徑：公開資訊觀測站>單一公司>股權變動/證券發行>董監大股東持股/質押/轉讓>董監事持股餘額明細>董監事持股餘額  
網址：<https://mops.twse.com.tw/mops/#/web/stapap1>

##### (二)股權移轉資訊：

1. 董事、監察人、經理人及持股比例超過百分之十之股東股權變動及股權質押情形：

115年4月23日；單位：股

職稱	姓名	114年度		115年截至4月23日	
		持有股數 增(減)數	質押股數 增(減)數	持有股數 增(減)數	質押股數 增(減)數
大股東兼董事長	林斯穎	451,662	-	-	-
董事兼總經理	陳文冠	88,584	-	-	-
董事兼資深副總經理	林逸羣	220,178	-	-	-
董事(註1)	張添昌	-	-	-	-
獨立董事	劉慧儀	-	-	-	-
獨立董事	洪欣儒	-	-	-	-
獨立董事	胡瑞卿	-	-	-	-
董事兼副總經理(註2)	張睿政	185,488	-	-	-
董事兼副總經理(註2)	邱哲儀	15,200	-	200,000	-
監察人(註2)	冠兆投資(股)公司	495,600	-	-	-
監察人(註2)	李復華	-	-	-	-
協理	陳俊良	29,828	-	-	-
資深顧問	桑友樂	29,298	-	-	-
特助	陳國烘	20,000	-	-	-
財務協理	江美雲	29,027	-	-	-
稽核協理	李倩倩	14,000	-	-	-
協理	呂致宏	10,000	-	-	-
會計主管兼公司治理主管	劉秀慧	-	-	-	-

註1：於115年第1次股東臨時會(115.2.11)選任董事、獨立董事。

註2：於115年第1次股東臨時會(115.2.11)辭任董事、監察人。

2. 董事、監察人、經理人及持股比例超過百分之十之股東股權移轉之相對人為關係人之資訊：

115年4月23日；單位：股

姓名	股權移轉原因	交易日期	交易相對人	交易相對人與公司、董事、監察人、經理人及持股比例超過百分之十股東之關係	股數	價格
林斯穎	以股票作價增加投資恆軒投資(股)公司	114.9.29	恆軒投資(股)公司	投資公司負責人之一親等	800,000	21.2008 (依公司114.9.8之股權淨值)
	贈與	114.9.22	林大為	一親等	110,000	21.2008 (依公司114.9.8之股權淨值)

(三)股權質押資訊：無

八、持股比例占前十名之股東，其相互間為關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係之資訊

115年4月23日；單位：股；%

姓名	本人持有股份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義合計持有股份		前十大股東相互間具有關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係者，其名稱或姓名及關係		備註
	股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例	名稱(或姓名)	關係	
林斯穎	3,855,819	18.27%	-	-	-	-	恆軒投資(股)公司	負責人為一親等	-
恆軒投資(股)公司 負責人:林大為	1,920,000	9.10%	-	-	-	-	林斯穎	監察人	-
林大為	119,832	0.57%	-	-	-	-	林斯穎	一親等	-
冠兆投資(股)公司 負責人:陳文冠	1,734,600	8.22%	-	-	-	-	-	-	-
陳文冠	287,493	1.36%	-	-	-	-	冠兆投資(股)公司	負責人	-
林逸羣	733,125	3.47%	-	-	-	-	-	-	-
呂瑞滿	714,645	3.39%	-	-	-	-	-	-	-
謝煥祥	621,818	2.95%	-	-	-	-	-	-	-
張睿政	611,710	2.90%	-	-	-	-	-	-	-
林政弘	442,054	2.09%	-	-	-	-	-	-	-
方 瑀	415,076	1.97%	-	-	-	-	-	-	-
李汝觀	387,499	1.84%	-	-	-	-	-	-	-

九、公司、公司之董事、監察人、經理人及公司直接或間接控制之事業對同一轉投資事業之持股數，並合併計算綜合持股比例

單位：仟股；%

轉投資事業	本公司投資		董事、監察人、經理人及直接或間接控制之事業之投資		綜合投資	
	股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例
瀚發貿易(上海)有限公司	(註1)	100%	-	-	(註1)	100%
東君能源系統(股)公司(註2)	375	12.5%	-	-	375	12.5%

註1：為有限公司無股數。

註2：該公司持續虧損，股東權益為負數，全數提列減損損失。

## 參、募集情形

### 一、股本來源

(一)敘明公司最近年度及截至年報刊印日止，已發行之股份種類

年月	發行價格(元)	核定股本		實收股本		備註		
		股數	金額	股數	金額	股本來源	以現金以外之財產抵充股款者	其他
76.07	-	-	5,000,000	-	5,000,000	有限公司設立，設立資本額為5,000仟元整	無	註1
86.09	-	-	10,000,000	-	10,000,000	辦理現金增資5,000仟元，增資後資本額為10,000千元	無	註2
88.08	10	1,000,000	10,000,000	1,000,000	10,000,000	變更組織為股份有限公司	無	註3
89.05	10	3,000,000	30,000,000	3,000,000	30,000,000	現金增資發行新股2,000仟股，每股面額10元，共計20,000仟元	無	註4
90.09	10	3,900,000	39,000,000	3,900,000	39,000,000	盈餘轉增資發行新股900仟股，每股面額10元，共計9,000仟元	無	註5
93.01	10	7,500,000	75,000,000	7,500,000	75,000,000	現金增資發行新股3,600仟股，每股面額10元，共計36,000仟元	無	註6
93.12	10	9,000,000	90,000,000	9,000,000	90,000,000	盈餘轉增資發行新股1,500仟股，每股面額10元，共計15,000仟元	無	註7
96.09	10	10,800,000	108,000,000	10,800,000	108,000,000	盈餘轉增資發行新股1,800仟股，每股面額10元，共計18,000仟元	無	註8
97.11	10	12,528,000	125,280,000	12,528,000	125,280,000	盈餘轉增資發行新股1,728仟股，每股面額10元，共計17,280仟元	無	註9
98.12	10	14,720,400	147,204,000	14,720,400	147,204,000	盈餘轉增資發行新股2,192.4仟股，每股面額10元，共計21,924仟元	無	註10
113.12	-	60,000,000	600,000,000	-	-	提高額定資本總額	無	註11
114.07	10	60,000,000	600,000,000	20,608,560	206,085,600	盈餘轉增資發行新股5,888.16仟股，每股面額10元，共計58,881.6仟元	無	註12
114.09	30	60,000,000	600,000,000	21,100,560	211,005,600	員工認股權轉換492仟股，每股面額10元，共計4,920仟元	無	註13

註1：發文日期：76.07.25 發文字號：建一字第27790號函核准在案

- 註 2：發文日期：86.09.10 發文字號：八六建三字第 230003 號函核准在案  
 註 3：發文日期：88.08.30 發文字號：經(八八)中字第 673247 號函核准在案  
 註 4：發文日期：89.05.16 發文字號：經(八九)中字第 426285 號函核准在案  
 註 5：發文日期：90.09.14 發文字號：經(九0)中字第 09032805420 號函核准在案  
 註 6：發文日期：93.01.06 發文字號：經授中字第 09331506550 號函核准在案  
 註 7：發文日期：93.12.10 發文字號：經授中字第 09333173880 號函核准在案  
 註 8：發文日期：96.09.18 發文字號：經授中字第 09632778680 號函核准在案  
 註 9：發文日期：97.12.18 發文字號：經授中字第 09734162330 號函核准在案  
 註 10：發文日期：98.12.22 發文字號：經授中字第 09835174590 號函核准在案  
 註 11：發文日期：114.01.02 發文字號：府經商行字第 11391191500 號函核准在案  
 註 12：發文日期：114.08.05 發文字號：府經商行字第 11490998520 號函核准在案  
 註 13：發文日期：114.09.30 發文字號：府經商行字第 11491069670 號函核准在案

股份種類	核定股本			備註
	流通在外股份(註)	未發行股份	合計	
記名式普通股	21,100,560	38,899,440	60,000,000	非屬上市或上櫃公司股票

(二)若經核准以總括申報制度募集發行有價證券者，另應揭露核准金額、預定發行及已發行有價證券之相關資訊：無。

## 二、主要股東名單

股權比例達百分之五以上之股東或股權比例占前十名之股東名稱、持股數額及比例：

115 年 4 月 23 日

主要股東名稱	股份	持有股數(股)	持股比例(%)
林斯穎		3,855,819	18.27%
恆軒投資股份有限公司		1,920,000	9.10%
冠兆投資股份有限公司		1,734,600	8.22%
林逸羣		733,125	3.47%
呂瑞滿		714,645	3.39%
謝煥祥		621,818	2.95%
張睿政		611,710	2.90%
林政弘		442,054	2.09%
方瑀		415,076	1.97%
李汝觀		387,499	1.84%

### 三、公司股利政策及執行狀況

#### (一) 公司章程所定之股利政策

本公司股利政策依循基本原則如下：董事會擬定盈餘分配案時，將考量公司所處環境及成長階段，並參酌盈餘分配對未來整體營運之影響，以決定股利發放之時機、條件、金額及種類，並提請股東會決議。

本公司年度總結算如有盈餘，應先提繳稅款、彌補虧損，次提百分之十為法定盈餘公積，但法定盈餘公積累積已達本公司資本額時，不在此限，並依法令規定提列或迴轉特別盈餘公積後，如尚有盈餘，其餘額再加計以前年度累積未分配盈餘，由董事會擬具分派議案，提請股東會決議分派股東紅利或保留盈餘。

考量本公司正處成長階段，現金股利發放不低於當年度發放總股利（現金股利及股票股利合計）之百分之十。

但若可供分配股東股利之總額未達每股 1 元時，則不受前項比率之限制。

#### (二) 本年度擬（已）議股利分派之情形

本公司於 115 年 3 月 30 日董事會決議通過 114 年盈餘分派案，將於 115 年 5 月 7 日股東常會決議通過分派每股 2 元之現金股利。

#### (三) 預期股利政策將有重大變動之說明：無此情事。

### 四、本次股東會擬議之無償配股對公司營業績效及每股盈餘之影響

不適用。

### 五、員工、董事及監察人酬勞

#### (一) 公司章程所載員工、董事及監察人酬勞之成數或範圍：

本公司年度如有獲利（即稅前利益扣除分配員工酬勞及董事監察人酬勞前之利益），應提撥：

1. 員工酬勞不低於 5% 為員工調整薪資或分派酬勞，應提撥之調整薪資金額或員工酬勞中，應有不低於 20% 分派予基層員工。
2. 董監酬勞不高於 3%。
3. 但本公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額。前項員工酬勞得以股票或現金為之，其發給對象得包括符合一定條件之控制或從屬公司員工，該一定條件授權董事會訂定之。

#### (二) 本期估列員工、董事及監察人酬勞金額之估列基礎、以股票分派之員工酬勞之股數計算基礎及實際分派金額若與估列數有差異時之會計處理：

本公司員工及董事、監察人以公司章程所訂之成數為基礎估列，經董事會

決議通過提報股東會。嗣後決議實際配發金額與估列金額有差異時，則按會計估計變動處理。

(三)董事會通過分派酬勞情形：

1. 以現金或股票分派之員工酬勞及董事、監察人酬勞金額。若與認列費用年度估列金額有差異，應揭露差異數、原因及處理情形：無此情事。
2. 以股票分派之員工酬勞金額占本期稅後純益及員工酬勞總額合計數之比例：無此情事。

(四)前一年度員工、董事及監察人酬勞之實際分派情形：

本公司業經 114 年 4 月 22 日董事會決議通過 113 年度員工酬勞及董監酬勞分派案，以現金分派之員工酬勞為新臺幣 15,200 仟元，董監酬勞為新臺幣 2,000 仟元，113 年度認列之費用與實際分派均無差異。

六、公司買回本公司股份情形：無

七、公司債辦理情形：無

八、特別股辦理情形：無

九、海外存託憑證辦理情形：無

## 十、員工認股權憑證辦理情形

- (一)公司尚未屆期之員工認股權憑證應揭露截至年報刊印日止辦理情形及對股東權益之影響。屬私募員工認股權憑證者，應以顯著方式標示：無。
- (二)累積至年報刊印日止取得員工認股權憑證之經理人及取得憑證可認股數前十大員工之姓名、取得及認購情形：

單位：仟股；仟元

	職稱	姓名	取得認股數量	取得認股數量占已發行股份總數比率	已執行			未執行				
					認股數量	認股價格(元)	認股金額	認股數量占已發行股份總數比率	認股數量	認股價格(元)	認股金額	認股數量占已發行股份總數比率
經理人	總經理	陳文冠	124	0.60	124	30	3,720	0.60	-	-	-	-
	資深副總	林逸羣										
	副總經理	張睿政										
	副總經理	邱哲儀										
	副總經理	陳國烘										
	資深顧問	桑友樂										
	協理	江美雲										
	協理	李倩倩										
	協理	陳俊良										
	協理	呂致宏										
會計主管	劉秀慧											
員工	員工	鄭春富	91	0.44	91	30	2,730	0.44	-	-	-	-
	員工	陳榮忠										
	員工	謝孟衡										
	員工	王泰興										
	員工	羅吉超										
	員工	王健南										
	員工	金宗煌										
	員工	陳建評										
員工	陳義峰											

註：係 114 年 7 月份辦理之已到期員工認股權憑證執行情形。

### 十一、限制員工權利新股辦理情形

- (一)凡尚未全數達既得條件之限制員工權利新股應揭露截至年報刊印日止辦理情形及對股東權益之影響：無。
- (二)累積至年報刊印日止取得限制員工權利新股之經理人及取得股數前十大之員工姓名及取得情形：無。

### 十二、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形

- (一)最近年度及截至年報刊印日止已完成併購或受讓他公司股份發行新股者：無。
- (二)最近年度及截至年報刊印日止已經董事會決議通過併購或受讓他公司股份發行新股者：無。

### 十三、資金運用計畫執行情形

本公司截至年報刊印日之前一季止，並無發行尚未完成或最近三年內已完成且計畫效益尚未顯現之情形。

## 肆、營運概況

### 一、業務內容

#### (一)業務範圍

1. 公司所營業務之主要內容：

- ◆ 機械設備製造、銷售與服務
- ◆ 電子零組件製造、銷售與服務
- ◆ 電腦及事務性機器設備銷售
- ◆ 電子材料銷售

2. 主要產品種類及其營業比重：

單位：新臺幣仟元

主要產品	113 年度		114 年度	
	銷售金額	營業比重	銷售金額	營業比重
代理設備及零配件	963,707	74.03%	1,085,999	80.62%
自製設備及零配件	138,110	10.61%	99,215	7.36%
佣金收入及其他	200,047	15.36%	161,922	12.02%
合計	1,301,864	100.00%	1,347,136	100.00%

3. 公司目前之產品（服務）項目：

本公司專注於半導體測試與封裝領域，長期深耕於產品代理、自主研發與製造、客製化方案及售後技術服務，提供涵蓋測試、封裝、製程、材料與系統整合的完整解決方案。主要產品與服務如下：

(1)銷售收入（代理商品）

係指本公司所代理之商品，主要包括：

**封裝與製程設備**

- ◆ 電漿清洗 (Plasma) 設備、AOI (2D/3D) 自動光學檢測、X-ray (2D/3D) 檢測設備。
- ◆ 真空焊接爐 (Vacuum Soldering Furnace)：專用於絕緣閘雙極電晶體 (IGBT)、碳化矽 (SiC) 等功率半導體封裝。
- ◆ EMI 濺鍍鍍膜機 (EMI Sputter)。
- ◆ 覆晶鍵合機 Flip Chip Bonder(FCB)／熱壓接合機 Thermo - Compression Bonder (TCB)：高頻寬記憶體(HBM)、晶圓堆疊整合製程 (CoWoS) 專用封裝製程設備。
- ◆ 基板與晶片切割機：應用於先進封裝基板及封裝後晶片之切割分離。
- ◆ 全自動點膠系統 Fully Automated Dispensing System：應用於 FCBGA / FCCSP 及高階封裝 CoWoS Underfill 點膠及 SiP 點膠。

## 封裝材料

- ◆ 模壓材料、電鍍藥水(Plating Chemical)、矽膠散熱膏(Silicone Paste)、矽膠型結構膠等材料。
- ◆ 晶圓切割研磨保護液、切割刀。
- ◆ 導線鍵合(Wire Bond)專用鋼嘴、瓷嘴。
- ◆ EMI 濺鍍用保護膠帶(EMI Sputter Tape)。
- ◆ 皂化液：應用於覆晶球柵陣封裝(FCBGA)／倒裝晶片接觸陣列封裝(FCLGA)／晶圓堆疊整合製程(CoWoS)封裝前段之助焊劑(Flux)清洗。
- ◆ 灌封膠(Encapsulation Adhesive)：應用於新能源產業高壓直流繼電器(Relay)之封裝保護。

## 測試設備

- ◆ 高低溫衝擊機：應用於半導體 IC 特性測試與失效分析，亦可用於光通訊產品量產測試、人工智慧(AI)系統及高效能運算(HPC)設備之工程驗證。
- ◆ 印刷電路板組裝(PCBA)飛針測試機：快速檢測印刷電路板模組之開短路及元件異常，適用於AI伺服器、醫療電子與工控市場。
- ◆ 微機電系統(MEMS)測試機：涵蓋智慧型手機、穿戴式裝置、車用安全系統之感測器測試。
- ◆ 功率模組測試機：應用於電動車馬達驅動、太陽能變流器等高電壓大電流應用。
- ◆ 類比 IC 與多功能測試平台(Analog IC / Mixed-Signal)：支援類比與混合訊號晶片之多元測試需求。
- ◆ 晶圓老化測試設備：模擬極端環境以篩選早期失效晶片，提升可靠性。
- ◆ 自動化分選機：於封裝後進行檢測與良品篩選。

## 測試設備周邊相關

- ◆ 測試介面板(Load Board)。
- ◆ 測試座(Socket)系列，涵蓋球柵陣列封裝(BGA)、無引腳方形扁平封裝(QFN)、晶圓級晶片尺寸封裝(WLCSP)等封裝形式，支援高速通訊、人工智慧(AI)、記憶體測試等應用。
- ◆ 紫外線設備及燈管，用於可擦除可編程唯讀記憶體。

## (2) 自主研發與製造(自製產品)

公司持續投入自主研發，具備完整之設計與製造能力，並提供客製化方案，主要產品包括：

## 生產設備

- ◆ 重力式 IC 分選機。

- ◆ B-Stage 膠印刷機、高速錫膏印刷機。
- ◆ 金屬蓋植片機、封蓋／植片機。

#### 檢測設備

- ◆ 全自動三光檢測機。
- ◆ 全自動水滴角量測系統、全自動晶圓厚度檢測系統、全自動膠高量測系統。

#### 製程設備

- ◆ 自動進出料 (Loader/Unloader) 系統設備：應用於多種自動化製程。
- ◆ 晶片分檢系統：提升良率與效率。

### (3) 服務與技術支援 (佣金收入及其他)

本公司亦重視客戶長期效益，提供完善之附加價值，相關收入來源包括：

- ◆ 透過技術與管理經驗，提供安裝、調校、程式開發與軟體授權服務。
- ◆ 協助客戶解決新世代封裝、高速測試之規格變化。
- ◆ 結合代理與自製產品，針對電動車、人工智慧 (AI)、高效能運算 (HPC)、工控等產業，提供涵蓋「測試—封裝—量產」的系統化整合方案，協助客戶提升生產效率與產品可靠性。
- ◆ 以上列示之維運服務。

### 4. 計畫開發之新產品 (服務)

本公司亦同步投入於先進積體電路封裝晶圓堆疊整合製程 (CoWoS) 相關之封蓋／植片系統研發。由於先進封裝 IC 於高效能運算 (HPC) 應用中對散熱需求日益提升，需藉由導入金屬蓋或鈹片 (Indium Foil) 作為導熱介質，以確保封裝穩定性與效能。

系統主要開發架構如下：

- (1) 框膠塗佈。
- (2) 散熱膏塗佈。
- (3) 封蓋對位與預壓合。
- (4) 封蓋熱壓合。
- (5) 先進封裝 CPO 模組 Handler 開發。

## (二) 產業概況

### 1. 產業之現況與發展

#### (1) 全球半導體市場

#### 市場規模與成長

世界半導體貿易統計協會 (WSTS) 在 2025 年春季預測指出，全球半導體市場將從 2024 年的約 6,000 億美元快速回升，2025 年預計成長

11.2%，達 7,009 億美元，邏輯與記憶體是主要成長動能。WSTS 進一步預期 2026 年市場規模將擴大至 7607 億美元，顯示生成式人工智慧(AI)與高效能運算(HPC)可望推升中長期景氣。

### WSTS 預估全球半導體成長

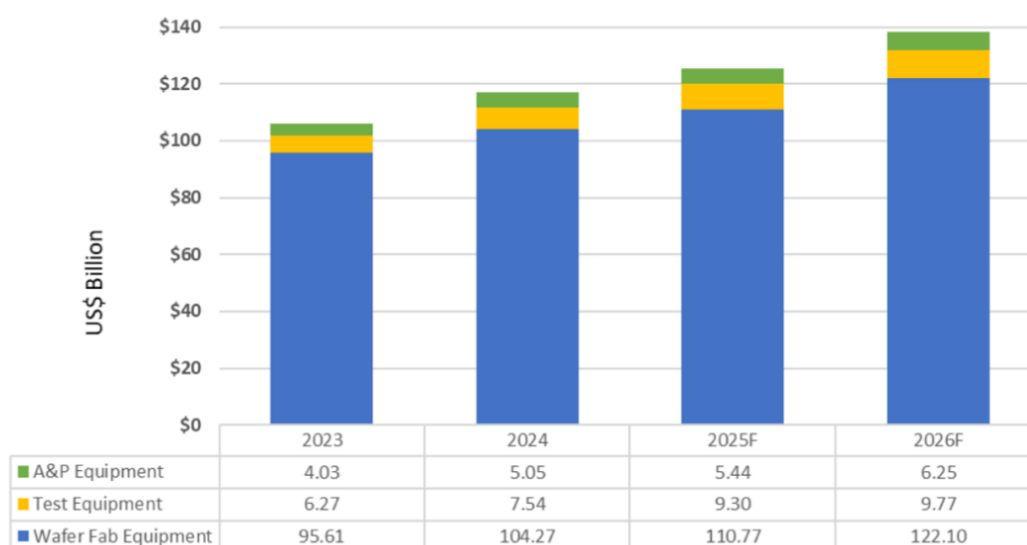
Spring 2025	Amounts in US\$M			Year on Year Growth in %		
	2024	2025	2026	2024	2025	2026
Americas	195,123	230,256	252,472	45.2	18.0	9.6
Europe	51,250	52,969	56,201	-8.1	3.4	6.1
Japan	46,739	47,037	49,776	0.0	0.6	5.8
Asia Pacific	337,437	370,613	402,252	16.4	9.8	8.5
<b>Total World - \$M</b>	<b>630,549</b>	<b>700,874</b>	<b>760,700</b>	<b>19.7</b>	<b>11.2</b>	<b>8.5</b>
Discrete Semiconductors	31,026	30,219	32,733	-12.7	-2.6	8.3
Optoelectronics	41,095	39,290	39,956	-4.8	-4.4	1.7
Sensors	18,923	19,782	20,622	-4.1	4.5	4.2
Integrated Circuits	539,505	611,582	667,390	25.9	13.4	9.1
Analog	79,588	81,642	85,535	-2.0	2.6	4.8
Micro	78,633	77,840	80,186	3.0	-1.0	3.0
Logic	215,768	267,259	286,842	20.8	23.9	7.3
Memory	165,516	184,841	214,826	79.3	11.7	16.2
<b>Total Products - \$M</b>	<b>630,549</b>	<b>700,874</b>	<b>760,700</b>	<b>19.7</b>	<b>11.2</b>	<b>8.5</b>

※資料來源：世界半導體貿易統計協會(WSTS)；2025/4

### 製造設備支出

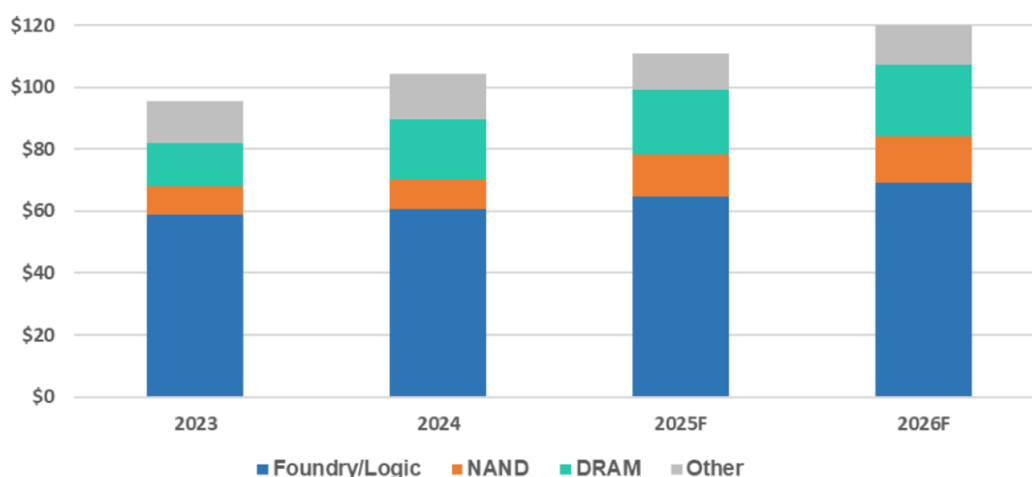
SEMI 於 2025 年中公布的《全球半導體製造設備預測》指出，全球半導體製造設備銷售額將在 2025 年達到 1,255 億美元，年增 7.4%，並於 2026 年提升至 1,381 億美元。其中晶圓製造設備 (WFE) 預計在 2025 年成長 6.2% 至 1,108 億美元；受人工智慧 (AI) 與高頻寬記憶體 (HBM) 帶動，測試設備 (Test Equipment) 銷售可望跳增 23.2% 至 93 億美元；封裝設備 (Packaging Equipment) 則預期成長 7.7% 至 54 億美元。

SEMI 2025 Mid-Year Total\* Equipment Forecast  
by Segment (US\$ Billion)



※資料來源：SEMI；2025/6

SEMI 2025 Mid-Year Wafer Fab Equipment Forecast  
by Application (US\$ Billion)



※資料來源：SEMI；2025/6

### 2024 年實績與區域分布

SEMI 統計 2024 年全球半導體設備銷售額 1,171 億美元，較 2023 年增加 10%。中國仍為最大設備市場，以 496 億美元占全球 42% 並年增 35%；韓國 205 億美元（年增 3%）、台灣 166 億美元（年減 16%），三地合計占全球設備支出逾七成。封裝設備與測試設備受人工智慧（AI）／高頻寬記憶體（HBM）熱潮驅動，在 2024 年分別大幅成長 25% 與 20%。

### Semiconductor Equipment Market Revenue by Region (U.S. Dollars in Billions)

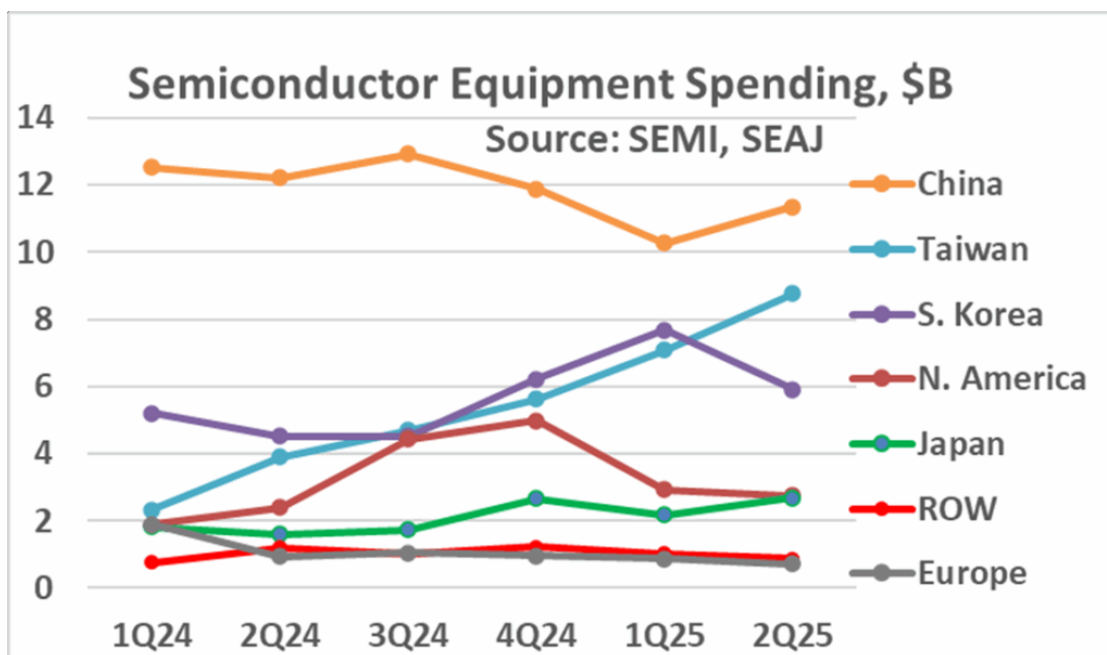
Region	2024	2023	(YoY) %
China	\$49.55	\$36.60	35%
Korea	\$20.47	\$19.94	3%
Taiwan	\$16.56	\$19.62	-16%
North America	\$13.69	\$12.05	14%
Japan	\$7.83	\$7.93	-1%
Europe	\$4.85	\$6.46	-25%
Rest of the World	\$4.19	\$3.65	15%
<b>Total</b>	<b>\$117.14</b>	<b>\$106.25</b>	<b>10%</b>

※資料來源：SEMI；2025/6

### 區域銷售趨勢

Semiconductor Intelligence 引用 SEMI/SEAJ 數據指出，2025 年第

2 季全球設備銷售 330.7 億美元，年增 23%。中國支出 113.6 億美元（占 34%，年減 7%），而台灣受先進製程投資回溫支出 87.7 億美元，年增 125%，韓國則為 59.1 億美元，年增 31%。該報告亦預估 2025 年全球半導體資本支出達 1,600 億美元，較 2024 年略為成長。



### 未來展望

- 市場規模高速增長：WSTS 在 2025 年秋季預測中指出，全球半導體市場於 2025 年將成長 22.5%，達約 7,722 億美元；SIA 統計顯示同年度實際銷售額達 7,917 億美元，年增 25.6%。展望 2026 年，WSTS 預計市場將再擴張逾 26%，達 9,754.6 億美元，SIA 亦指出全球銷售有望接近 1 兆美元。
- 產品結構聚焦邏輯與記憶體：WSTS 預測邏輯與記憶體是成長主軸，2025 年邏輯產品預計成長約 37%、記憶體約 28%；2026 年兩者仍有逾三成增幅。其他產品類別，如感測器、類比及微控制器等，呈現溫和復甦。
- 區域增長差異化：WSTS 預估，美洲與亞太地區於 2025 - 2026 年將以 25 - 30% 的速度增長；歐洲增幅約 6%，日本則在 2025 年略為下滑後於 2026 年恢復低雙位數成長。SIA 的統計亦顯示，2025 年亞太/其他市場增幅最大（45%），美洲成長 30.5%，中國為 17.3%，歐洲為 6.3%。
- 需求驅動與發展動能：生成式 AI、雲端運算、高效能運算、6G、物聯網與自駕車等新興應用持續推升邏輯與高頻寬記憶體需求。這些趨勢預示市場將維持高成長態勢，同時也為先進封裝、測試設備與材料供應商帶來長期商機。

## (2) 中國半導體市場地位與結構

### 設備支出規模

路透社援引 Tech Insights 的分析指出，中國在 2024 年購買了 410 億美元的晶圓製造設備 (WFE)，占全球約 40%；然而受產能過剩與美國出口限制影響，2025 年中國設備支出預計降至 380 億美元，其全球占比可能從 40% 滑落至 20%。這顯示中國市場成長動能正放緩，對國外先進曝光機及測試設備 (Test Equipment) 依賴仍高。

### 先進封裝與後端能力

BCG 與 SIA 的研究指出，中國與台灣合計約 60% 的全球封裝、測試與組裝 (ATP) 產能。中國封裝測試產能占全球超過 30%，且後端設備採購年增率高於前端。由於成本與政策優勢，未來數年中國仍是封裝設備主要買家。

### 未來擴張與限制

儘管成熟節點 (28nm、40nm) 產能擴建迅速，中國在極紫外光微影 (EUV) 與先進製程方面仍受技術與出口管制阻礙；報告預估中國 2024 年新增晶圓產能將占全球新增產能最大比重，但 2025 年及以後增長可能放緩。

### 未來展望

- 掌握人工智慧 (AI) 與先進封裝需求：WSTS 和 SEMI 的預測顯示邏輯、記憶體及先進封裝是成長主軸。企業應把握生成式人工智慧 (AI)、高效能運算 (HPC) 和資料中心需求，優先佈局與高頻寬記憶體 (HBM)、高密度封裝相關的設備與服務。
- 注意區域投資節奏：中國仍是最大設備市場，但 2024 年後增長放緩。投資策略應兼顧台灣、韓國等正在加速設備採購的市場。
- 觀察資本支出與景氣循環：2025 年全球設備支出雖持續成長，但地緣政治和去庫存循環將影響設備廠訂單。建議跟蹤客戶拉貨動能，適時調整庫存與產能。

## (3) 台灣半導體市場地位與結構

### 全球關鍵角色

亞太基金會 2025 年分析指出，台灣生產全球超過 60% 的半導體，其中最先進的晶片佔比逾 90%，是全球第一大封裝測試基地並在 IC 設計 (IC Design) 領域位居第二。台積電在 GPU (Graphics Processing Unit) 代工領域幾乎壟斷，顯示台灣在人工智慧 (AI) 與高階製程中的關鍵地位。

### 產業結構

台灣晶圓代工產能約占全球 60%，封測市占率也超過 60%。隨著台積電與聯電在先進製程及封裝領域持續擴產，相關設備與材料需求將增加。此外，台灣 90 - 95% 的製造投資留在本地，但亦積極拓展日本、美國與德國等海外據點。

### 未來展望

- 深化與台灣供應鏈合作：台灣在先進製程和封裝技術方面領先，可透過與台積電、聯電及封測大廠合作，共同開發客製化測試介面（Load Board）、測試座（Socket）等高階產品，提升產品技術含金量。
- 利用地緣優勢：台灣享有成熟供應鏈與政府支持，可作為亞太區域服務與研發中心，加強跨區域營運與供應鏈韌性。
- 跟蹤海外擴產動態：台積電等廠商在日本、德國與美國新建晶圓廠，未來相關設備和技術需求會外溢，代理商應提前佈局海外服務據點。

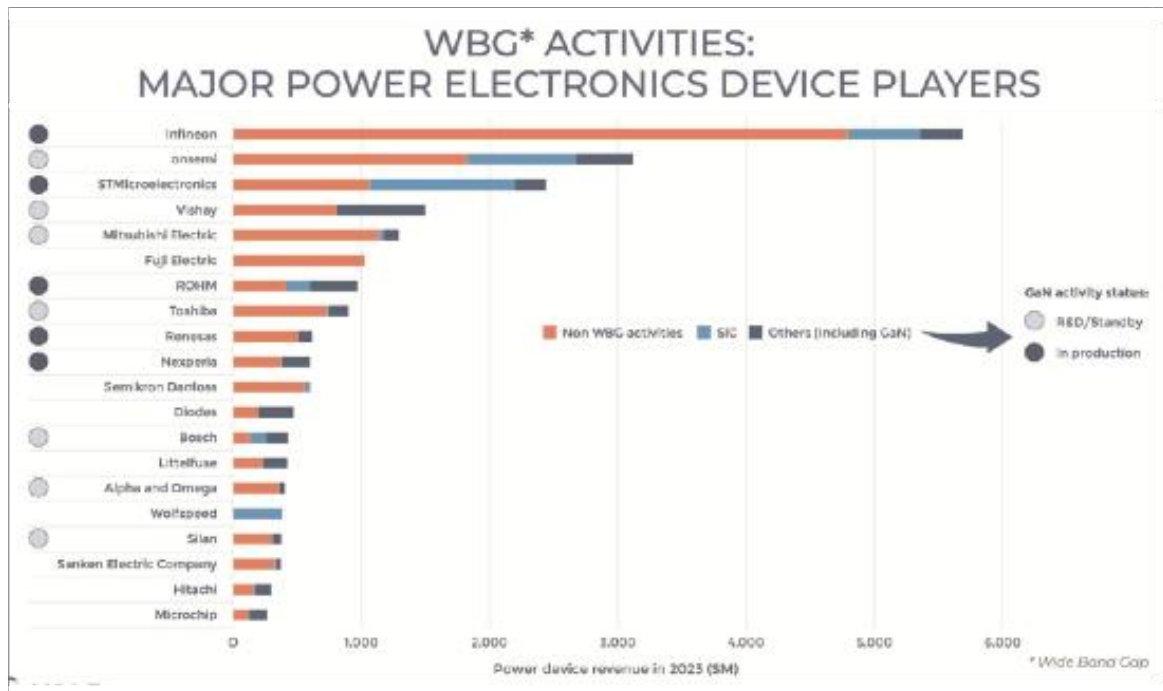
#### (4) 晶圓產能擴張與化合物半導體趨勢

### 封裝產能集中與分散

BCG/SIA 報告指出，全球約 95 億美元的封裝、測試與組裝（ATP）市場高度集中於東北亞，其中中國與台灣合計持有近 60% 的全球產能。東南亞已擁有約 20% 的全球 ATP 產能，未來在政策支持下預計 2032 年提升到 27%。美國目前僅佔少數市場份額，正透過 CHIPS and Science Act（CHIPS Act）鼓勵在地化封裝投資。

### 化合物半導體成長迅速

Yole Group 於 2025 年報告指出，化合物半導體（Compound Semiconductor）器件市場（涵蓋碳化矽（SiC, Silicon Carbide）、氮化鎵（GaN, Gallium Nitride）、砷化鎵（GaAs, Gallium Arsenide）、磷化銦（InP, Indium Phosphide）等）2024 - 2030 年間年複合成長率近 13%，預計到 2030 年達約 250 億美元；此類產品雖仍僅占整體半導體市場小部分，但可支援高電壓、高頻率及高溫環境，對電動車、電力電子與 5G 基站（5G Base Station）至關重要。報告同時預測功率碳化矽（SiC）市場至 2029 年將達 100 億美元，功率氮化鎵（GaN）市場超過 20 億美元。另外，矽光子（Silicon Photonics）與磷化銦光子雷射（InP Photonic Laser）市場被預期在 2029 年達 50 億美元。



※資料來源 semiconductorTODAY:2025March

### 未來展望

- 提前布局碳化矽 (SiC) / 氮化鎵 (GaN) 測試與散熱方案：隨電動車與高功率應用普及，SiC 與 GaN 器件需求快速增長。建議加強高溫高壓測試設備 (Test Equipment)、先進散熱材料與封裝解決方案研發，並與原廠合作導入至汽車與工控領域。
- 關注先進封裝與晶粒模組化 (Chiplet) 技術：全球封裝產能正在區域分散，異質整合 (Heterogeneous Integration) 與 Chiplet 已成為先進封裝發展方向。可與研究機構合作開發客製化測試介面 (Load Board)、測試座 (Socket) 及自動化封裝模組，搶佔高端應用市場。
- 布局東南亞與美國產能擴張：報告預估東南亞 ATP 產能將在 2032 年大幅提升。建議在馬來西亞、越南等地建立服務據點，以跟上產業分散趨勢，並留意美國 CHIPS Act 對本地封裝產能的推升。

### (5) 與瀚軒業務的關聯與策略意涵

#### 設備需求持續擴大，代理與自製並進

全球測試及封裝設備需求因人工智慧 (AI)、高效能運算 (HPC) 與車用電子迅速成長，SEMI 預測 2025 年測試設備 (Test Equipment) 年增 23.2%。瀚軒代理的高速測試座 (Socket)、電漿清洗設備與 X 光檢測 (X-ray) 系統，以及自製封蓋機、植片機、水滴角量測機等產品，皆直接對應此需求。建議加強與客戶的技術合作與客製化能力，提供整合型解決方案。

## 中國市場的機會與風險並存

中國設備支出仍居世界第一，但 2025 年可能下滑至 380 億美元。瀚軒可在測試設備 (Test Equipment) 與自動化系統加強差異化競爭，並考慮與中國本土廠商合作或建立策略聯盟，同時警覺政策與價格競爭風險。

## 在地化服務與供應鏈韌性

全球供應鏈逐漸區域化，客戶要求快速回應。瀚軒已在台灣與中國多地設立據點，可進一步強化應用工程與售後服務團隊，在東南亞新興市場也設立服務據點，以提高客戶黏著度。

## 化合物半導體 (Compound Semiconductor) 與新興應用提前布局

Yole 預測化合物半導體市場年複合成長率 13%，碳化矽 (SiC) 與氮化鎵 (GaN) 市場將快速擴大。瀚軒可攜手國際原廠開發高溫高壓測試設備 (Test Equipment) 及散熱方案，搶占電動車與第五代行動通訊 (5G) 基站 (Base Station) 市場。同時，投資小晶片模組化設計 (Chiplet) 與異質整合 (Heterogeneous Integration) 相關的測試介面與自動化封裝技術，以掌握下一波產業成長。

## 長期策略

差異化競爭與跨區域佈局，避免陷入價格競爭，透過技術升級、材料與服務整合，提供客戶更高附加價值。結合台灣的研發優勢與海外營運據點，建立跨區域的靈活供應鏈，以應對地緣政治與市場波動。

## 2. 產業上、中、下游之關聯性

本公司所屬產業為半導體設備與材料供應鏈，主要提供測試與封裝相關之設備、材料與客製化解決方案，位於半導體產業鏈的中游環節。其產業上、中、下游關聯性如下：

(1) 上游產業：包括半導體原物料與零組件供應商、國際設備與材料原廠，其範疇包含：

- ◆ 半導體製程關鍵材料：矽晶圓、導熱膠材、模壓材料、電鍍液、切割刀具及各類耗材。
- ◆ 專業設備製造商：晶圓製造設備 (WFE)、檢測設備 (Test Equipment) 及自動化模組之國際品牌原廠。
- ◆ 零組件與模組供應：感測元件、光學零組件、馬達、控制器、印刷電路板 (PCB)、基板等。

上游供應鏈的技術進步與價格波動，將直接影響本公司採購成本、產品設計及銷售毛利率。

(2) 中游產業：中游為本公司所處環節，主要涵蓋半導體封裝與測試設備 (Packaging & Test Equipment) 及材料之代理銷售、自製研發與技術服務，其角色包含：

- ◆ 代理產品銷售：引進國際先進設備與材料，提供客戶多元化解決方案。
- ◆ 自製產品研發：專注於重力式 IC 分選機、B-Stage 膠印刷機、檢測設備、全自動進出料系統、封蓋/植片機等，並可依客戶需求提供客製化設計。
- ◆ 技術服務支援：涵蓋安裝、調校、維修、零件供應與製程優化，協助客戶提升良率與效率。

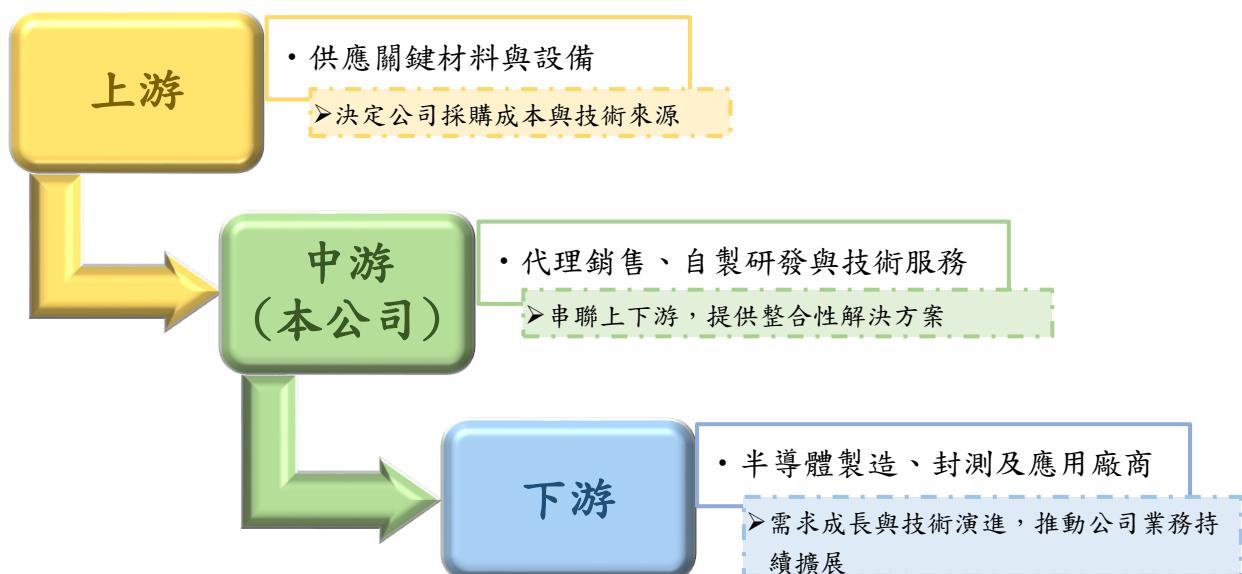
本公司透過代理與自製並行策略，形成良好互補，能快速回應下游客戶之需求，並與國際原廠及客戶建立長期合作關係。

(3) 下游產業：下游主要為半導體製造、封裝與測試代工 (OSAT)、晶圓代工 (Foundry)、垂直整合元件製造商 (IDM) 及系統應用端，其應用涵蓋：

- ◆ 晶圓代工與封測業者：應用本公司設備與材料進行先進封裝與測試，以支撐人工智慧 (AI)、高效能運算 (HPC)、第五代行動通訊 (5G)、車用電子等市場。
- ◆ IDM 與系統廠商：如車用電子、伺服器、通訊與消費電子產業，對產品的良率、散熱與可靠性要求極高。
- ◆ 最終應用市場：涵蓋人工智慧 (AI) / 高效能運算 (HPC) 資料中心、智慧手機、穿戴式裝置、電動車與自駕系統等多元應用。

下游需求的成長與轉型，將直接推動本公司產品線的升級與服務模式調整。

產業鏈互動關係總結為：



整體而言，本公司扮演「技術橋樑與解決方案供應商」的角色，透過結合上游國際原廠與下游客戶需求，提供涵蓋測試、封裝與自動化的完整產品與服務，並隨產業趨勢持續升級。

### 3. 產品之各種發展趨勢

#### (1) 人工智慧 (AI)、高效能運算 (HPC)：

人工智慧 (AI) 與高效能運算 (HPC) 的快速發展，正將全球半導體產業推向新一波的效能革命，而高效能運算 (HPC) 系統需要整合數以千計的處理器與加速器，互連延遲與功耗管理成為瓶頸。由於傳統的單晶片架構已難以負荷龐大的運算需求，先進封裝技術脫穎而出，成為支撐人工智慧 (AI) 與高效能運算 (HPC) 的核心基礎設施。因為這兩個領域需要極致的運算效能與高頻寬記憶體存取，而 2.5D 與 3D 封裝是現階段最關鍵的解決方案，使得人工智慧 (AI) 與高效能運算 (HPC) 成為先進封裝的最大受惠者。在人工智慧 (AI) 與高效能運算 (HPC) 的應用場域中，可見高頻寬 (>1TB/s)、低延遲 (奈秒等級)、高良率 (降低大晶片製程風險)、高散熱效率 (功耗>500W 的 AI 晶片需特殊散熱設計)，已成為封裝的四大基本需求。

為了使資料傳輸速率突破每秒 1TB，先進封裝技術透過矽中介層，邏輯晶片與高頻寬記憶體 (HBM) 得以緊密整合，來顯著提升 AI 模型訓練與推論效率。而台積電的晶圓堆疊整合製程 (CoWoS) 技術已成為 NVIDIA 與 AMD 高階 AI 加速器的標配，英特爾則以 Foveros 技術推動 3D 堆疊架構 (3D Stacking)，透過垂直整合降低延遲並優化功耗。

另一股重要趨勢是 Chiplet 架構，與其冒險生產龐大且高風險的單一晶片，Chiplet 採取模組化設計，不同功能的模組可在各自最佳化製程下製造，再透過先進封裝進行系統級整合。這種設計不僅降低大晶片的良率風險與製造成本，還能提供高度彈性，讓晶片設計如同「樂高積木」般自由組合，而台積電的矽上晶圓整合技術 (SoIC) 以及英特爾的 3D 封裝技術 Foveros，皆展現出晶片設計邁向平台化、模組化的未來走向。

隨著人工智慧 (AI) 與高效能運算 (HPC) 不斷挑戰運算極限，台積電的晶圓堆疊整合製程 (CoWoS) 與矽上晶圓整合技術 (SoIC)、英特爾的 3D 封裝技術 Foveros、三星的混合基板封裝 H-Cube 等先進封裝技術方案，不僅是晶片效能優化的技術突破，更是開啟數位經濟與智慧應用新時代的關鍵引擎。

系統級封裝 (SiP) 能將多種異質元件整合於單一模組中，使得如米粒般大小的封裝即可具備完整系統功能，同時透過低功耗設計延長電池壽命。而扇外型封裝 (Fan-out Package)、矽光子共同封裝 (CPO)、晶片堆疊等先進技術，則能進一步縮小封裝體積、降低功耗，並提升異質整合度，讓穿戴式裝置與智慧感測器能兼顧功能與便攜性。隨著物聯網 (IoT) 興起，終端設備需承擔更多數據的即時處理任務，這對運算效

能提出新要求，也進一步推動先進封裝技術在 IoT 領域的應用。

#### (2) 汽車電子的「電動化」與「智慧化」：

先進封裝在車用感測器、車載資訊娛樂系統、先進駕駛輔助系統（ADAS）以及電動傳動系統的功率模組中扮演著越來越重要的角色，提供更耐用、更可靠且高效能的解決方案。在電動化方面，動力控制系統是最關鍵的應用之一，隨著碳化矽（SiC）與氮化鎵（GaN）等寬能隙半導體材料廣泛導入，使得功率模組能在高壓與高溫條件下高效運作。在智慧駕駛領域，自動駕駛與先進駕駛輔助系統（ADAS）對運算能力需求快速上升。汽車需要即時處理來自雷達、光達與攝影機等感測器的龐大數據，因此高效能 AI 晶片的導入勢在必行。這些晶片常透過 2.5D 或 3D 封裝技術整合 GPU 與專用加速器，以滿足低延遲與高安全性的要求，同時，小型化的系統級封裝（SiP）在感測器融合模組中也逐漸普及，使得汽車能在有限空間內整合更多功能。

先進封裝對汽車產業的影響除了效能提升外，同時也驅動了車輛安全、可靠與智慧化的發展，無論是強調高電流承載與散熱的功率模組，支撐感測器融合的小型化 SiP，還是推動自駕運算平台的 GPU 與 AI 加速器異質整合，先進封裝正成為汽車半導體市場持續成長的關鍵引擎。

#### 4. 產品之競爭情形

本公司所屬產業為半導體製造業，專注於半導體封裝業務相關材料及設備解決方案之代理，並同時自製半導體封裝相關自動化設備。隨著先進製程推動高效能運算（HPC）、人工智慧（AI）與資料中心等應用需求快速成長，封裝技術亦持續朝高密度與高效能方向演進。當前市場主流的先進封裝技術包括晶圓堆疊整合製程（CoWoS）及面板級封裝製程（PLP）等，已成為半導體產業升級的關鍵技術路徑。

##### (1) 代理產品競爭情形

在國內市場，本公司主要競爭對手為具備規模經濟與垂直整合能力的封測廠商。相較之下，本公司在產品品質及技術服務效能方面具明顯優勢，尤其在應對先進封裝日益複雜、多樣化的產品組成需求時，能提供高度彈性及客製化的材料與設備整合方案，有效協助客戶加速產品導入與驗證流程。

本公司代理產品亦支援客戶於製程關鍵節點實施即時檢驗與監控，助其建立動態品質控管機制，提升製程穩定度與成品良率，滿足高階應用對封裝可靠度與精密度的嚴格要求。然而，價格方面因部分競爭者採用低價策略或具備規模採購優勢，本公司相對處於劣勢，故須依賴技術差異化、產品組合優化與深化售後服務來強化市場定位。

##### (2) 技術發展與布局

面板級封裝製程（PLP）技術的興起為先進封裝帶來新契機，利用大面積基板提升產能利用率並降低成本，全球多家領導廠商正積極建置相

關產線，對傳統封裝模式產生衝擊。除此之外，晶圓堆疊整合製程(CoWoS)及矽光子共同封裝(CPO)等先進封裝技術因其在高效能運算(HPC)及高頻高速訊號傳輸領域的卓越表現，成為市場競爭重點。本公司積極強化面板級封裝製程(PLP)、晶圓堆疊整合製程(CoWoS)及矽光子共同封裝(CPO)相關材料與設備代理佈局，並配合特定應用導入試產平台所需關鍵設備與耗材，以應對產業快速變革的競爭挑戰。

全球供應鏈區域化趨勢日益明顯，國際系統廠對在地材料與設備的供應服務需求增加，推升本地專業代理商成長動能。面對新進業者持續投入，市場競爭日趨激烈，本公司將持續強化產品組合策略，深化與原廠夥伴及關鍵客戶合作關係，提升市場占有率與整體營運效能。

### (3) 自製產品競爭情形

本公司自製產品為半導體封裝相關之自動化設備，具備優異穩定性、操作介面友善與高度整合性，能有效提升客戶生產製程自動化水平。自製設備不僅能與其他廠商設備整合使用，亦可依客戶需求進行客製化設計，快速反應並調整產品功能，展現強大軟硬體整合能力，並提供完整售後服務支持，確保客戶生產營運持續穩定。

自製設備與代理材料及設備形成良好互補，雙方產品共同協助客戶實現不同層面之生產自動化要求。自製設備除提升生產效能，亦成為客戶控制生產成本的重要選項，進一步強化本公司在半導體封裝產業鏈的競爭優勢與服務價值。

## (三) 技術及研發概況

### 1. 所營業務之技術層次及研究發展

#### (1) 專業技術能力

本公司長期深耕於半導體測試與封裝設備領域，累積豐富的設備開發經驗，並具備以下專業核心能力：

- ◆ 機台結構設計與最佳化
- ◆ 料盒自動化傳輸技術
- ◆ 基板流道設計與自動取放機制
- ◆ JEDEC (Joint Electron Device Engineering Council) 標準流道與分料設計
- ◆ 積體電路(IC)材料管之自動輸送系統
- ◆ 積體電路(IC)測試治具之開發與應用
- ◆ 高精度影像定位技術
- ◆ 影像分析與演算技術

#### (2) 人工智慧(AI)應用發展

在影像缺失辨識方面，傳統演算法常因缺失模式無法有效歸納而產生例外狀況。為提升系統可靠度，本公司正積極規劃導入機器學習與人

工智慧 (AI) 技術，以取代傳統演算法進行圖形判讀。此舉可有效減少例外模式管理之負擔，提升缺陷辨識之正確率與系統之使用友善性。

### (3) 新世代技術研發

除既有專業能力之持續精進外，本公司亦積極投入下一代高階封裝技術之開發，現正進行「高階封裝積體電路 (IC) 金屬蓋封蓋系統」及「散熱銅片植片系統」之研發工作，期能滿足先進製程及高效能運算 (HPC) 應用對散熱解決方案日益嚴苛之需求，進一步鞏固本公司於高階封裝領域之技術優勢與市場地位。

## 2. 研究發展人員與其學經歷

單位：人；%

學歷	113 年		114 年		115 年截至 3 月底	
	人數	比率	人數	比率	人數	比率
博士	—	—	—	—	—	—
碩士	5	36%	5	39%	5	36%
大學(專)	9	64%	8	61%	9	64%
高中(含) 以下	—	—	—	—	—	—
合計	14	100%	13	100%	14	100%

## 3. 最近五年度每年投入之研發費用

單位：新臺幣仟元；%

年度 項目	110 年	111 年	112 年	113 年	114 年
研發費用	(註)	39,676	25,625	26,050	24,109
營業收入		1,243,762	986,077	1,301,864	1,347,136
研發費用占 營業收入淨 額比率(%)	-	3.19	2.60	2.00	1.79

※註：本公司 110 年度未編製合併財報。

## 4. 最近五年度開發成功之技術或產品

本公司技術與產品開發，著重在產品應用上的研究與發展歷程，並透過過往經驗、現行技術應用與未來發展規劃，確立部門與公司的戰略目標與發展藍圖。主要的技術成果如下：

年份	機器名稱	功能 / 技術
2021	3D ToF sensor test platform	測試 3D 人臉辨識感測器模組。
2022	T+R rework machine	將有缺失的捲帶，重工。

年份	機器名稱	功能 / 技術
2022	Wafer skeleton analyzer	分析殘留的晶粒，判斷挑選機有沒有挑錯。
2022	Auto tray exchanger	將 IC 依照出貨的要求重新排列。
2023	Peel force meter	測量並管制封帶的結合力。
2023	Auto cassette loader / unloader	輸送裝在料盒的產品進入點膠機，並送回料盒。
2023	Wafer detape tool	將貼在晶圓的膠帶安全快速脫離。
2024	Wafer thickness and roughness meter	量測薄化後的晶圓厚度與粗糙度。
2024	Contact angle meter	量測產品的潔淨度，在無人生產線。
2025	Contact angle meter for COWOS	量測產品的潔淨度，在無人生產線，並整合 EFEM 模組。
2025	Chiplet inspection through the wafer tape	透過膠膜檢查小晶粒的切割道與表面品質。

#### (四)長、短期業務發展計畫

##### 1. 短期發展計畫：現行技術應用與發展持續鑽研

###### 強化核心代理產品銷售

- 持續引進國際原廠最新之封裝與測試設備（如晶圓堆疊整合製程（CoWoS）專用清洗設備、SLT（System Level Test）測試系統）及關鍵材料（導熱膠材、封裝用模壓材料、高頻寬記憶體（HBM）封裝配套）。
- 與原廠合作提供技術導入與應用工程服務，提升客戶黏著度。

###### 擴大自製產品滲透率

- 提升積體電路（IC）Tray、測試座（Socket）與 Load Board 的客製化設計與快速交付能力，爭取封測代工廠（OSAT）與晶圓代工客戶量產訂單。
- 開發符合人工智慧（AI）/高效能運算（HPC）高速高頻需求的先進 Socket 與 Tray，搶占高速運算與資料中心利基市場。

###### 強化在地化技術與服務

- 在台灣與中國據點擴建應用工程與售後維護團隊，提供即時技術支援與備件服務。
- 與大客戶成立「聯合工程小組」，協助封裝與測試製程驗證、良率改善及新產品導入。

### 營運優化

- 建立跨部門產品管理制度，推動代理產品與自製產品協同銷售。
- 導入 ERP (Enterprise Resource Planning, 企業資源規劃)，提高供應鏈透明度與成本控管效率。

## 2. 中長期發展計畫：發展方向與戰略

### (1) 技術升級與應用擴展

依現行技術與市場趨勢，未來發展將聚焦於：

#### 技術升級

- 投入研發資源於高精度自製自動化模組，提升毛利結構與附加價值。
- 與國際原廠共同開發晶圓 (Chiplet) 封裝測試、扇出式面板級封裝製程 (Fan-out PLP) 自動化系統及矽光子共同封裝 (CPO) 配套設備。
- 導入智能化檢測與數據追溯方案，推動製程自動化與人工智慧 (AI) 驅動的製程優化。

#### 應用面擴展

- 人工智慧 (AI) / 高效能運算 (HPC)：聚焦高頻寬記憶體 (HBM)、2.5D/3D 封裝、Chiplet 測試與高速 Socket 方案
- 車用半導體：佈局車規高可靠度測試需求 (高溫循環、長壽命 Socket、車規材料)，滿足電動車與先進駕駛輔助系統 (ADAS) 應用。
- 高速光通訊：強化高速傳輸測試與矽光子共同封裝 (CPO) 封裝解決方案。

### (2) 市場拓展與合作機會

#### 市場拓展

- 深化台灣與中國市場，鞏固主要半導體製造與封測客戶群。
- 積極拓展東南亞 (新加坡、越南、馬來西亞) 市場，以因應供應鏈區域化與轉單效應。

#### 合作機會

- 與國際設備與材料原廠建立策略聯盟，爭取區域獨家代理權。
- 與晶圓代工、封裝與測試代工 (OSAT) 廠共同開發先進封裝與測試應用平台。
- 與研究機構及大學合作，探索新型材料及先進製程配套技術。

本公司將以「先進封裝與測試整合解決方案供應商」為長期定位，透過短期鞏固代理與服務、中期擴大自製產品滲透、長期深化技術研發與市場拓展，逐步建立差異化優勢。未來三至五年，本公司將聚焦：

- ◆ 提升自製產品比重，優化毛利結構。
- ◆ 深化人工智慧 (AI) / 高效能運算 (HPC)、車用電子與高速光通訊應用佈局。
- ◆ 與原廠及客戶建立長期合作關係，強化產業鏈地位。
- ◆ 以 ESG (環境、社會與公司治理) 與永續經營為核心，確保企業長期穩健發展。

## 二、市場及產銷概況

### (一) 市場分析

#### 1. 公司主要商品 (服務) 之銷售 (提供) 地區

單位：新臺幣仟元；%

年度 地區	113 年度		114 年度	
	營收金額	比率	營收金額	比率
內銷	381,652	29.32%	387,086	28.73%
外銷	920,212	70.68%	960,050	71.27%
合計	1,301,864	100.00%	1,347,136	100.00%

#### 2. 市場占有率

本公司專注於半導體封裝測試部分，涵蓋傳統封裝測試及先進封裝測試等多元領域。

#### 3. 市場未來之供需狀況與成長性

- (1) 市場快速成長：外包封裝與測試 (OSAT) 與整體封裝市場在 2025 - 2030 年間預期維持高個位數到雙位數年複合成長 (CAGR 年複合成長率) 約 7 - 11% 範圍 (視報告而異)。這主要被人工智慧 (AI) / 高效能運算 (HPC)、高頻寬記憶體 (HBM)、汽車電子與邊緣運算 (Edge Computing) 驅動。
- (2) 先進封裝比重上升：2.5D/3D、扇外型晶圓級封裝 (Fan-out WLP)、小晶片模組化設計 (Chiplet) 與高密度倒裝封裝 (Flip-Chip) 需求明顯提升，先進封裝在整體出貨和營收中的比重持續增加。
- (3) 供應鏈在地化需求：半導體封裝與測試代工 (OSAT) / 先進封裝設備如混合鍵合技術 (Hybrid-Bonding)、精密對位、基板/介面片 (Interposer, 矽中介層) 與測試能力為後續在地化的重點，部分半導體大廠已在快速擴產以因應人工智慧 (AI) 需求。
- (4) 區域化/重構供應鏈趨勢：美國與歐洲的在地化投資 (CHIPS Act, 美國晶片與科學法案；歐盟半導體計畫) 將促成區域性產能，但亞洲 (台灣、

韓國、中國) 短期仍主導大量產能與技術領先。

#### 4. 公司競爭利基及發展遠景之有利因素

##### (1) 本公司的競爭利基：

###### ◆ 多元化產品線與完整解決方案

本公司代理涵蓋測試設備、封裝製程設備與材料、真空焊接爐、老化測試設備及測試座(Socket)等完整產品組合，能針對電動車、人工智慧(AI)/高效能運算(HPC)、高速光通訊、醫療電子與工業自動化等多樣化應用市場提供整合解決方案，降低對單一產品或市場之依賴。

###### ◆ 深厚代理經驗與國際夥伴關係

自1987年成立以來，累積近四十年半導體產業經驗，長期代理多家國際知名設備與材料品牌，與歐美、日、韓等原廠建立穩固合作關係，確保產品技術水準與服務品質。

###### ◆ 技術服務與在地化支援能力

除設備銷售外，本公司提供安裝、測試開發、維護保養與應用諮詢等全方位服務，並於台灣及中國設有據點，可即時回應客戶需求，提升黏著度與市場競爭力。

###### ◆ 研發與創新導向

公司積極投入影像辨識、人工智慧(AI)應用及高階封裝散熱技術之研發，發展下一代封蓋/散熱系統，以掌握先進製程所需之關鍵技術，提升產品差異化與附加價值。

###### ◆ 高度客製化能力

在封裝測試設備領域，能依客戶需求提供高速、高頻、高可靠性的專屬解決方案，建立差異化競爭優勢，避免落入價格競爭。

##### (2) 發展願景之有利因素：

###### ◆ 半導體產業長期成長動能

全球人工智慧(AI)、高效能運算(HPC)、電動車、高速光通訊與物聯網持續發展，推升先進封裝與測試需求，公司所代理與研發之產品正好切入高成長應用領域，市場前景廣闊。

###### ◆ 電動車與功率半導體需求驅動

碳化矽(SiC)、氮化鎵(GaN)等功率半導體應用快速成長，帶動真空焊接爐、功率模組測試與老化設備需求，公司在此領域具備產品與代理優勢。

###### ◆ 人工智慧(AI)與自動化技術導入

公司規劃導入機器學習與人工智慧(AI)技術於影像辨識，提升設備準確性與使用友善性，符合產業對智慧製造之需求，具備未來發展潛力。

###### ◆ ESG與國際標準導入

將啟動 ESG 架構導入，以符合 ISO 9001 等國際品質管理體系，有助於取得國際客戶信任，提升海外市場拓展能力。

(3) 公司發展的 SWOT 分析：

分析面向	內容摘要
優勢 (Strengths)	<ul style="list-style-type: none"> <li>近 40 年半導體設備代理與服務經驗，品牌信譽深厚。</li> <li>多元化產品線，涵蓋測試設備、封裝設備、真空焊接、老化測試與 Socket 解決方案。</li> <li>與歐美、日、韓原廠建立長期合作關係，技術門檻高。</li> <li>提供完整售後與技術服務，在地化支援能力強。</li> <li>積極研發人工智慧 (AI) 影像辨識與高階封裝散熱解決方案，具差異化優勢。</li> </ul>
劣勢 (Weaknesses)	<ul style="list-style-type: none"> <li>現有的規模與國際大型設備供應商相比，規模有限。</li> <li>需持續投入研發與人才培養，以維持技術領先地位。</li> </ul>
機會 (Opportunities)	<ul style="list-style-type: none"> <li>全球人工智慧 (AI)、高效能運算 (HPC)、電動車與高速通訊帶動先進封裝與測試需求。</li> <li>功率半導體碳化矽；氮化鎵 (GaN) 快速成長，推升焊接與可靠性測試需求。</li> <li>供應鏈在地化需求封裝與測試代工 (OSAT) / 先進封裝設備如混合鍵合 (Hybrid-Bonding)、精密對位、基板 / 介面片 (Interposer, 矽中介層) 與測試能力為後續尋求在地化的重點。</li> <li>智慧製造趨勢明顯，人工智慧 (AI) 與機器學習技術應用於影像辨識可提升市場競爭力。</li> <li>ESG (環境、社會與公司治理) 與國際品質標準有助於取得更多國際客戶信任。</li> </ul>
威脅 (Threats)	<ul style="list-style-type: none"> <li>半導體產業具高度循環性，市場需求波動大。</li> <li>來自中國及其他亞洲地區廠商的價格競爭壓力。</li> <li>國際地緣政治與貿易壁壘可能影響供應鏈與市場佈局。</li> <li>原料或零組件成本波動可能壓縮利潤。</li> <li>客戶導入新世代封裝或測試規格，若未能即時因應，可能影響市佔率。</li> </ul>

5. 發展遠景之不利因素與因應對策

發展遠景之不利因素	不利因素之相關說明	因應對策
匯率波動風險	國際交易以外幣計價，匯損影響獲利	採取避險工具及自然對沖
技術變動風險	產品快速演進，設備需求更新快速	投入研發與強化產品汰換規劃
地緣政治風險	全球局勢可能影響供應鏈	建立多地物流與備援供應機制

## (二)主要產品之重要用途及產製過程

### 1. 主要產品及其用途

本公司長期深耕於半導體產業，提供涵蓋生產設備、測試設備、檢驗設備、自動化模組、高階材料及零組件的完整解決方案，協助客戶提升製程效率、產品良率與生產穩定性。公司業務模式兼具代理銷售、自主研發製造、客製化設計與技術服務，並透過在地化工程支援，持續鞏固與擴展市場地位。本公司之業務主要分為：

#### (1)設備收入

本公司提供完整之製程與測試設備代理與銷售涵蓋：

- ◆ 生產設備：如點膠機、電漿清洗機、自動混液注入設備、自動貼膜機、B-Stage 膠印刷機、封蓋／植片機、全自動進出料系統等。
- ◆ 檢驗設備：如 X-Ray、三光檢測機、水滴角量測機、2D/3D 光學檢測機。
- ◆ 輔助設備：應用於封裝與測試流程中的自動化模組。

除代理銷售外，本公司亦承接客戶自動化專案，提供整合設計與技術導入，並負責設備採購、進口、安裝、樣品試作、試產、量產導入及驗收等全流程服務。在設備驗收完成後，本公司提供保固與技術支援，確保客戶可迅速啟動量產，降低導入風險。

#### (2)材料收入

本公司銷售多元化的高階半導體材料涵蓋：

- ◆ 導熱與封裝膠材：用於高效散熱及高階封裝製程。
- ◆ 模壓材料、皂化液：應用於晶圓層級封裝 (WLP) 與凸塊製程 (Bump Process)。
- ◆ 切割與鐳線耗材：如晶圓切割刀、保護液、導線鍵合 (Wire Bond) 專用鋼嘴與瓷嘴。

本公司致力於提升材料利用效率並降低製程耗損，同時積極拓展小晶片模組 (Chiplet)、2.5D/3D 積體電路 (2.5D/3D IC) 封裝、扇外型封裝 (Fan-out)、矽光子共同封裝 (CPO) 等先進製程所需之材料業務，滿足客戶對高效能、高可靠度製程的需求。

#### (3)勞務收入

本公司除設備與材料銷售外，亦提供涵蓋全生命週期的專業服務包括：

- ◆ 設備安裝、調校、試產導入、功能驗收。
- ◆ 保固期內之維修與零件更換。
- ◆ 保固期後之長期維護、定期保養、功能升級與軟體更新。
- ◆ 移廠移機及製程優化服務。

本公司透過精準掌握客戶需求，協助其新產品從開發至量產階段的順利落地，並在生產過程中持續改善良率與效率。

#### (4) 零件收入

本公司為確保客戶產線的穩定性，本公司提供設備關鍵零組件與消耗品，並建置備品備件庫存以滿足即時需求。零件供應搭配維修服務形成整合方案，確保客戶之生產設備能長期穩定運作，進而提升整體營運效能。

### 2. 主要產品之產製過程

#### (1) 代理產品

由國際原廠供應之設備與材料經由本公司代理銷售，並提供進口、報關、安裝、驗收及售後維護服務。公司憑藉豐富的專業經驗，協助客戶縮短設備導入時程，加速新產品量產。

#### (2) 自製產品

由公司研發設計，搭配關鍵零組件採購，進行組裝、測試與品質驗證。可依客戶需求進行客製化設計或功能調整，並與現有產線設備高度整合。

#### (3) 技術服務與零件供應

透過在地化工程與維護團隊，提供安裝調校、維修保養、升級改造及零件供應。確保設備全生命週期之穩定運作，降低客戶營運中斷風險，協助其提升生產良率與產能利用率。

### (三) 主要原料之供應狀況

本公司主要原料包括代理類商品及自製產品類所需之加工件與標準部品，分別應用於生產設備、測試設備、檢驗設備、自動化模組、高階材料及零組件產品之製程中。原料主要來自國內外多家長期合作關係良好的供應商，提供穩定的品質與準確的交期建立互信互惠關係。

目前供應狀況如下：

#### 1. 代理類商品

主要由美國、歐洲、新加坡、日本、中國及韓國供應商提供，保持暢通即時的溝通管道，品質穩定，交期準確以降低風險。

供應狀況:良好

#### 2. 自製產品類所需之加工產品與標準部件

由台灣本地供應商或零部件代理商供應，公司已採取多元採購策略，具備快速反應能力確保供應商的產品生產時程能滿足本公司的需求。

供應狀況:良好

因應全球供應鏈變動，本公司持續關注原料市場動態，自製產品方面透過建立第二供應來源、增加庫存彈性及強化供應商管理機制，以確保原料供應之穩定性與生產不中斷。在供應商管理方面，本公司每年定期進行供應商評鑑，以確保供應商的產品品質、製程設變能力、交期準確度及服務品質。

(四)最近二年度任一年度中曾占進(銷)貨總額百分之十以上之客戶名稱及其進(銷)貨金額與比例，並說明其增減變動原因：

1. 最近二年度主要供應商資料

單位：新台幣仟元；%

項目	113年				114年			
	名稱	金額	占全年度進貨淨額比率(%)	與發行人之關係	名稱	金額	占全年度進貨淨額比率(%)	與發行人之關係
1	D公司	88,475	12.43	無	D公司	168,570	23.29	無
2	C公司	74,131	10.42	無	C公司	96,325	13.31	無
3	A公司	72,978	10.25	無	F公司	78,283	10.81	無
	其他	476,136	66.90		其他	380,694	52.59	
	進貨淨額	711,720	100.00		進貨淨額	723,872	100.00	

增減變動原因分析：本公司進貨總額10%以上之供應商之變動情形如下：  
 ① A公司營運業務調整，改變全球的代理策略與經銷區域。  
 ② F公司因客戶需求異動對應增減採購單量。

2. 最近二年度主要客戶資料

單位：新台幣仟元；%

項目	113年				114年			
	名稱	金額	占全年度銷貨淨額比率(%)	與發行人之關係	名稱	金額	占全年度銷貨淨額比率(%)	與發行人之關係
1	甲公司	143,175	11.00	無	甲公司	139,221	10.33	無
	其他	1,158,689	89.00		其他	1,207,915	89.67	
	銷貨淨額	1,301,864	100.00		銷貨淨額	1,347,136	100.00	

增減變動原因分析：變動未達10%。

三、最近二年度及截至年報刊印日止從業員工資料

年度		113年	114年	當年度截至 115年3月31日
員工人數	研發人員	14	13	14
	一般職員	130	140	140
	合計	144	153	154
平均年歲		43.3	43.5	43.4
平均服務年資		11.3年	11.2年	11.0年
學歷分布比率	博士	0%	0%	0%
	碩士	8%	8%	10%
	大學(專)	91%	91%	89%
	高中以下(含)	1%	1%	1%

#### 四、環保支出資訊

- (一)最近年度及截至年報刊印日止，因污染環境所遭受之損失：無此情事。
- (二)依法令規定，應申領污染設施設置許可證或污染排放許可證或應繳納污染防治費用或應設立環保專責單位人員者，其申領、繳納或設立情形：  
本公司非屬應檢具水污染防治措施公告中之事業種類、範圍及規模，不需檢具水污染防治措施備查；廢水產生量未超過相關法令規範，亦不需設置廢水處理專責人員。另本公司非屬應申請設置、變更及操作許可之固定污染源公告中之行業或製程，不需設置相關設施及污染防制計畫書，且本公司亦非屬應設置空氣污染防制專責單位公告之事業單位，故未設置專責單位及人員。
- (三)公司有關對防治環境污染主要設備之投資及其用途與可能產生效益：無此情事。
- (四)公司對環保相關費用支出情形：  
◆ 廢棄物回收處理申報費用：本公司依相關法令規定，定期辦理廢棄物回收申報，以合法清理廢棄物且回收資源廢棄物。  
◆ 污水下水道使用費：本公司依規定期繳納污水下水道使用費，此費用為本公司履行環保義務、確保廢水妥善處理之支出。

#### 五、勞資關係

- (一)列示公司各項員工福利措施、進修、訓練、退休制度與其實施狀況，以及勞資間之協議與各項員工權益維護措施情形

本公司以員工為本，當員工全心全力的投入工作，為公司創造利潤的同時，公司也擔負起照顧員工、關懷員工與回饋員工的責任。公司提供多項福利並成立職工福利委員會，負責規劃國內、外尾牙旅遊、員工家庭日、耶誕餐會等，增進員工彼此間的情誼，凝聚員工與公司間的向心力，激發每位同仁對公司的認同感與向心力，達成以員工為本之目標。

##### 1. 員工福利措施與實施情形：

本公司為增進員工福利，除依中華民國勞動基準法相關規定之健康保險及勞工保險及提撥勞工個人退休金帳戶制度之外，並提供員工團體保險、定期健康檢查，持續規劃多元員工福利政策，並致力於提升員工的職場環境，現行之福利措施要項包括：

- (1)薪資獎金福利：具有競爭力的薪酬水準、提供獎金福利包含員工認股、依法之加班費、未休假獎金、年終獎金、依績效表現之員工紅利。
- (2)休假福利：員工所享有之相關休假權益，比照勞基法規定之週休二日、特休制度、不扣薪災防假、員工陪產假、產假、育嬰假等。
- (3)保險及健檢福利：本公司依政府規定為員工投保勞保、健保、團體意外保險、團體醫療保險等，每二年並提供員工定期健康檢查。
- (4)休閒與保障：除符合勞基法的休假制度外，另給予員工彈性上下班、

遠距辦公申請、年終尾牙、部門聚餐、年節禮盒、員工服務年資福利獎勵、高齡親屬照護假等福利。

- (5) 職工福利：本公司為員工辦理各項包括但不限於：結婚、生育、喪葬、開工紅包、個人教育訓練補助並定期舉辦各項活動。
- (6) 員工旅遊補助：本公司每年提供補助，舉辦員工國內或國外旅遊。
- (7) 其他福利：本公司提供視障者按摩服務，備有咖啡機組，咖啡無限供應，零食、不定期下午茶等。

## 2. 員工進修及訓練：

在面臨產業缺工與企業永續經營的時代背景挑戰，培育良好的學習型組織是未來企業成功的關鍵，要達到永續經營的關鍵是「人才」，透過年度教育訓練計劃表執行教育訓練，內部訓練和外部訓練並進，以強化各機能別員工之專業能力，培育未來企業所需的潛力人才，以員工職涯管理為核心發展訓練計畫，以達到育才留才的目標。

### (1) 對應的行動計畫

提供全方位的學習課程，從新人、到在職夥伴的基礎培育，甚至是中高階管理傳承等多元課程，定期舉辦內外部教育訓練且鼓勵夥伴在職進修，養成優秀人才傳承企業文化與理念打造永續基業。

### (2) 訓練之類型

- ◆ 新進人員職前訓練：提供有關公司之企業文化、營業項目、工作規則、員工福利、獎懲規定等課程，讓新進人員對公司有基本的認識。
- ◆ 在職人員訓練：依工作所需安排實施內、外訓等各項訓練課程。
- ◆ 專業職能訓練：依需要派同仁至相關機構受訓，讓同仁取得專業的檢驗認證。

### (3) 產生之成效

- ◆ 知識傳承：教育訓練傳授工作經驗與提升工作能力，增強職業競爭力，培育出符合組織永續經營目標的人才。
- ◆ 員工生涯發展：發展各職位各職缺應具備的學習的技能與知識評估，透過完善的職能地圖與員工面談了解員工設定的目標和現況的差距，準確評估其優點和強項，協助定位職涯方向與目標，讓員工能感受受到企業重視，能在良好的職涯發展路徑中，對工作有方向性與成就感，長遠自我實現工作價值。
- ◆ 提升員工向心力：企業永續經營需要所有員工齊心為了共同目標努力，才能養成永續價值的文化，是企業達到永續經營的深耕之道。提供員工職涯發展與教育訓練課程除了提升工作上的專業，更可以透過訓練課程與技術交流，讓公司成員更加了解彼此，也有助於在工作事項上的溝通效率。

## 3. 退休制度與實施情形：

本公司員工依照勞工退休金條例規定，員工皆適用新制退休金條例，由

公司每月提撥不低於百分之六之勞工退休金提繳率，並按行政院核定之月提繳工資分級表提繳儲存於該從業人員在勞工保險局設立之勞工退休金個人專戶。

#### 4. 勞資間之協議與各項員工權益維護措施情形

本公司各項規定皆依勞動基準法為遵循準則，本公司一向重視員工權益，定期每三個月舉辦勞資會議，以促進勞資雙方並維持良好和諧之互動關係及讓公司制度也更加完善，故本公司之勞資關係和諧，並無勞資糾紛及損失發生。

##### (1) 工作環境保護措施

公司設有內部共享資源「員工專區」，統整包含公司制度、福利制度、教育訓練、內部相關管理辦法資訊與其他內部資源，並定期檢討修訂相關內容，以維護員工權益。

##### (2) 人身安全保護措施

- ◆ 每二年員工健檢補助及公假（健檢）0.5 天。
- ◆ 訂立性騷擾防治措施申訴及懲戒辦法。
- ◆ 員工申訴信箱及申訴電話。

(二) 說明最近二年度及截至年報刊印日止，公司因勞資糾紛所遭受之損失（包括勞工檢查結果違反勞動基準法事項，應列明處分日期、處分字號、違反法規條文、違反法規內容、處分內容），並揭露目前及未來可能發生之估計金額與因應措施，如無法合理估計者，應說明無法合理估計之事實：

本公司最近二年度及截至年報刊印日止，並無發生因勞資糾紛所遭受之損失而足以影響公司財務、業務正常營運之情事。

## 六、資通安全管理

(一) 資通安全風險管理架構、資通安全政策、具體管理方案及投入資通安全管理之資源等。

### 1. 資通安全風險管理架構

本公司已任命資訊部主管為資通安全主管，負責統籌推動公司資安政策與管理機制，強化資訊資產之保護。另本公司每年皆將資訊相關作業納入內部稽核計畫，並將稽核結果提報監察人及董事會，以確保資安管理制度之有效性與持續改善。

### 2. 資通安全政策

本公司建立完善的資通安全政策與內部控制制度，透過資訊部門職責劃分、系統開發與程式修訂、資料存取與輸出控管、設備安全與系統備援等多項作業程序，全面管理資訊資產風險。相關資安控制作業以書面程序文件規範執行，並依據年度稽核與運作情形持續檢討精進，確保資訊系統

之安全性、完整性與可用性本公司將持續強化資訊安全管理，透過完善的政策與管理機制，確保資訊資產的安全性與營運的穩定性，為企業發展提供強而有力的保障。

### 3. 具體管理方案

為確保公司資訊資產安全與業務持續運作，本公司訂定並落實資通安全政策，涵蓋日常作業管理、權限控管、設備防護、資料保全、異地備份與稽核機制等面向，並定期檢討與修訂資安措施，以因應潛在風險與外部威脅。

### 4. 資通安全管理資源

本公司已任命資訊部主管為資通安全主管，負責統籌資安政策之規劃與執行，並督導資安制度之推動與資安事件之應變。此外，本公司亦委由具專業能力之資訊服務公司提供技術支援，協助系統維運、資安防護、漏洞修補及異常監控等作業，確保資訊系統之穩定與安全。

未來將視業務發展與資安風險評估結果，持續投入必要人力與資源，以提升整體資通安全治理能量。

(二)列明最近年度及截至年報刊印日止，因重大資通安全事件所遭受之損失、可能影響及因應措施，如無法合理估計者，應說明其無法合理估計之事實：無此情事。

## 七、重要契約

目前仍有效存續及最近一年度到期之供銷契約、技術合作契約、工程契約、長期借款契約及其他足以影響投資人權益之重要契約，載明當事人、主要內容、限制條款及契約起訖日期。

契約性質	當事人	契約起訖日期	主要內容	限制條款
銷售契約	TWYJ007	2024/8/15 - 2026/8/14	機台/零件	保密協定
銷售契約	SGAG001	2025/1/1 ~ 2026/12/31	機台	保密協定
銷售契約	TWRY008	2025/1/1 起	機台/零件/原料	保密協定
銷售契約	TWRY006	2025/1/1 起	機台/零件/原料	保密協定
銷售契約	TWTJ002	2025/1/1 起	機台/零件/原料	保密協定
銷售契約	TWXP003	2025/1/3 起	機台/零件/原料	保密協定
銷售契約	TWEZ001	2020/6/1 起	機台/零件	保密協定
銷售契約	TWHT004	2025/6/1 起	機台/零件/原料	保密協定
銷售契約	TWVG001	2023/12/14 起	機台/零件/原料	保密協定

契約性質	當事人	契約起訖日期	主要內容	限制條款
銷售契約	TWQL009	2019/7/24 起	零件	保密協定
採購契約	SGKE001	2024/2/1 ~ 2027/2/1	原料	保密協定
採購契約	CNMO002	2021/7/27 起	原料	保密協定
採購契約	JPMU001	2022/10/1 ~ 2027/10/1	機台/零件	保密協定
採購契約	DEPV001	2004/7/20 起	機台/零件	保密協定
採購契約	ITSP001	2019/1/22 起	機台/零件	保密協定
採購契約	KRHA001	2025/4/30 起	機台/零件	保密協議
採購契約	USMI002	2025/1/1 起	機台/零件	保密協議
採購契約	SGKE001	2025/1/1 起	原料	保密協議
採購契約	KRSP001	2014/1/1 起	原料	保密協議
採購契約	CNDB001	2025/4/21 起	原料	保密協議
採購契約	CNHY019	2025/7/3 起	機台/零件	保密協定
採購契約	SGKE001	2012/2/10 起	原料	保密協定
採購契約	TWYM003	2026/3/10 起	測試載板/零件	保密協定
採購契約	TWWZ003	2022/10/24 起	機台/零件	保密協定
借款合同	兆豐國際商業銀行	2025/7/1 ~ 2026/6/30	短期借款	無
房屋租約	瀚笙科技(股)公司	2026/1/1 ~ 2026/12/31	房屋租賃契約	無
房屋租約	南科管理局	2026/1/1 ~ 2026/12/31	房屋租賃契約	無
房屋租約	謝增祥/謝芳芬/謝煥祥/林大為	2024/3/1 ~ 2029/2/28	土地租賃契約	無
房屋租約	上海衡山國際發展有限公司	2025/9/1 ~ 2028/8/31	房屋租賃契約	無
房屋租約	蘇州工業園區科智商業管理有限公司	2022/8/20 ~ 2027/8/19	房屋租賃契約	無
房屋租約	陳國烘	2024/1/1 ~ 2027/12/31	房屋租賃契約	無
房屋租約	鄭啟元	2024/1/1 ~ 2027/12/31	房屋租賃契約	無
倉庫租約	陳國烘	2024/1/1 ~ 2027/12/31	倉庫租賃契約	無

## 伍、財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項

### 一、財務狀況

最近二年度資產、負債及權益發生重大變動之主要原因及其影響，若影響重大者應說明未來因應計畫：

合併財務狀況-國際財務報導準則

單位：新臺幣仟元

項目 \ 年度	113 年度	114 年度	差異		增減變化比例分析說明 (註 1)
			金額	%	
流動資產	785,310	939,026	153,716	19.57	
不動產、廠房及設備	62,765	52,154	(10,611)	(16.91)	
無形資產	8,199	6,869	(1,330)	(16.22)	
其他資產	21,352	34,445	13,093	61.32	(註 2)
資產總額	877,626	1,032,494	154,868	17.65	
流動負債	374,338	442,086	67,748	18.10	
非流動負債	95,064	84,866	(10,198)	(10.73)	
負債總額	469,402	526,952	57,550	12.26	
股本	147,204	211,006	63,802	43.34	(註 3)
資本公積	0	12,211	12,211	100.00	(註 4)
保留盈餘	263,132	284,250	21,118	8.03	
其他權益	(2,112)	(1,925)	187	(8.85)	
非控制權益	0	0	0	0	
權益總額	408,224	505,542	97,318	23.84	(註 5)

註 1：若增減變動比例達 20%且金額超過新臺幣一仟萬者始加以分析說明。

註 2：主要係土地使用權資產增加所致。

註 3：係盈餘轉增資所致。

註 4：主要本期執行員工認股權溢價及股份基礎給付交易所致。

註 5：主要係持續獲利所致。

※資料來源：經會計師查核簽證之財務報告。

## 二、財務績效

### 合併財務績效結果比較分析-國際財務報導準則

單位：新臺幣仟元

項目	年度	113 年度	114 年度	增(減)變動		增減變化比例分析說明 (註 1)
				金額	%	
營業收入		1,301,864	1,347,136	45,271	3.48	
營業成本		765,162	803,564	38,402	5.02	
營業毛利		536,703	543,572	6,869	1.28	
營業費用		368,699	400,845	32,146	8.72	
營業(損)益		168,004	142,727	(25,277)	(15.05)	
營業外收入及支出		11,603	14,238	2,635	22.71	
稅前淨利		179,607	156,965	(22,642)	(12.61)	
所得稅費用(利益)		57,350	63,613	6,263	10.92	
本期淨利		122,257	93,352	(28,905)	(23.64)	(註 2)
本期其他綜合損益		12,167	1,555	(10,612)	(87.22)	(註 3)
本期綜合損益總額		134,424	94,907	(39,517)	(29.40)	(註 4)
註 1：若增減變動比例達 20%且金額超過新臺幣一仟萬者始加以分析說明。 註 2：本期淨利：係營業費用增加致獲利減少所致。 註 3：本期其他綜合損益：主要係上期人民幣貶值幅度較大致國外營運機構財務報表換算之兌換差額增加所致。 註 4：本期綜合損益總額：係營業費用增加，致獲利減少所致。						

※資料來源：經會計師查核簽證之財務報告。

## 三、現金流量

### (一)最近年度現金流量變動之分析說明：

單位：新臺幣仟元；%

項目	年度	現金流入(流出)		增(減)變動	
		113 年度	114 年度	金額	%
營業活動之淨現金流入(流出)		164,032	119,489	(44,543)	(27.16)
投資活動之淨現金流入(流出)		14,958	17,547	2,589	17.31
籌資活動之淨現金流入(流出)		(1,632)	(54,621)	(52,989)	3,246.88
現金流量變動情形分析：					
1. 營業活動淨現金流入：係獲利減少致營業活動淨現金流入減少所致。 2. 投資活動淨現金流出：係減少投資所致。 3. 籌資活動淨現金流入：係償還銀行借款所致。					

(二)流動性不足之改善計畫：本公司截至年報刊印日止資金尚屬充裕，未有流動性不足之情事。

(三)未來一年現金流動性分析：

單位：新臺幣仟元

期初現金餘額 (1)	預計全年來自營業活動淨現金流量 (2)	預計全年來自投資活動淨現金流量 (3)	預計全年來自籌資活動淨現金流量 (4)	預計現金剩餘(不足)數額 (1)+(2)+(3)+(4)	預計現金不足額之補救措施	
					投資計畫	理財計畫
374,148	147,192	(370,680)	394,177	544,837	-	-
1. 未來一年現金流量變動情形分析： (1)營業活動：主係營業收入成長，使營業活動現金流入。 (2)投資活動：主係本期增加廠房投資，使投資活動現金流出。 (3)籌資活動：主係現金增資 188,465 仟元及新增銀行借款 200,000 仟元，使籌資活動現金流入。 2. 預計現金不足額之補救措施及流動性分析：不適用。						

#### 四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響

本公司 114 年度無重大資本支出。

#### 五、最近年度轉投資政策、其獲利或虧損之主要原因、改善計畫及未來一年投資計畫

(一)本公司轉投資政策

本公司專注於本業，最近年度轉投資政策係以本公司業務相關能產生投資綜效者為投資標的，投資決策及作業程序遵循經本公司董事會或股東會通過訂定之「取得或處分資產處理之管理辦法」及「對子公司監理之管理辦法」等規範，並依內部控制制度之投資循環規定作業；各轉投資子公司除遵循本公司規定外，亦考量在地法令規定及實際營運狀況進行適當內控管理。

(二)最近年度轉投資政策、其獲利或虧損之主要原因：

單位：新臺幣仟元

轉投資公司	轉投資政策	114 年度認列之投資(損)益	獲利或虧損之主要原因	改善計畫	未來一年投資計畫
瀚發貿易(上海)有限公司	直接投資擴展大陸市場	109,444	營運狀況正常	-	-
東君能源系統(股)公司	長期投資獲利	-	產品未能有效推廣	-	-

(三)未來一年投資計畫：

本公司未來一年投資仍以業務相關投資綜合效益者為主要目標。

## 六、風險事項

(一)利率、匯率變動、通貨膨脹情形對公司損益之影響及未來因應措施：

1. 利率變動情形對公司損益之影響及未來因應措施

單位：新臺幣仟元；%

項目 \ 年度	113年度		114年度	
	金額	占營收金額比率	金額	占營收金額比率
利息收入	2,366	0.18%	2,174	0.16%
銀行利息支出	137	0.01%	284	0.02%

本公司113年度及114年度之合併利息收入分別為2,366千元及2,174千元，占當年度合併營業收入比率分別為0.18%及0.16%；合併銀行利息支出則分別為137千元及284千元，佔當年度合併營業收入比率分別為0.01%及0.02%。利息收入及利息支出占合併營業收入比率皆低，影響甚微，故利率變動對本公司營運無重大影響。

本公司之營運主要以自有資金為主，財務結構穩健，並與銀行及金融機構維持長期且穩定的合作關係，確保資金調度靈活順暢。在良好的信用紀錄與財務狀況支持下，若未來有短期資金融通需求，可透過市場比較與議價機制，選擇最具競爭力的融資方案，進一步降低資金成本，以維持財務的穩健性與營運效率。因此，即使市場利率有所變動，憑藉本公司穩健的資金管理策略與靈活應對機制，仍可有效降低財務風險，確保營運不受重大影響，持續維持穩定發展，預計未來利率變動對本公司整體營運不致產生重大影響。

2. 匯率變動情形對公司損益之影響及未來因應措施

單位：新臺幣仟元；%

項目 \ 年度	113年度		114年度	
	金額	占營收金額比率	金額	占營收金額比率
淨外幣兌換利益 (損失)	(64)	(0.00%)	(2,654)	(0.20%)

本公司產生之兌換利益(損失)主係因美金、日幣及人民幣匯率波動所致，雖佔本公司營業收入淨額比率不大，本公司仍隨時掌握國際匯市主要貨幣之資訊及經濟環境變動情形，並與往來銀行保持密切聯繫以掌握匯率走勢，維持適當之外匯淨部位，適時調控外幣部位轉換成新台幣，必要時將採用適當的匯率避險工具，以降低匯率波動所造成之影響，且本公司未來將持

續與金融機構保持聯繫，蒐集即時匯率資訊，並適時採取各項因應措施以降低匯率變動風險，故匯率變動對本公司尚無重大影響。

### 3. 通貨膨脹情形對公司損益之影響及未來因應措施

近年來，全球經濟環境受到多重因素影響，包括地緣政治紛擾加劇、供應鏈緊張，以及原物料與能源價格持續上漲，導致整體市場呈現微幅通貨膨脹之趨勢。雖然部分產業已受到成本上升的衝擊，但本公司憑藉穩健的經營策略，截至目前尚未因通貨膨脹而產生立即且重大之影響。本公司將持續密切關注國際經濟動態，並針對原物料價格波動進行即時評估，適時調整採購策略與庫存管理，必要時亦將採取適當的風險控管及穩定成本措施，以降低通貨膨脹對公司營運之影響，確保公司營運維持穩定成長，並持續提升競爭優勢。

## (二) 從事高風險、高槓桿投資、資金貸與他人、背書保證及衍生性商品交易之政策、獲利或虧損之主要原因及未來因應措施：

### 1. 從事高風險、高槓桿投資之政策、獲利或虧損之主要原因及未來因應措施

本公司專注於本業經營，財務政策以穩健保守為原則。最近年度及截至年報刊印日止，未有從事高風險、高財務槓桿投資之衍生性商品交易之情事。

### 2. 從事資金貸與他人、背書保證及衍生性商品交易之政策、獲利或虧損之主要原因及未來因應措施

本公司於113年度及114年度截至年報刊印日止，無資金貸與他人及為他人背書保證之情事，本公司未來若有資金貸與或為他人背書保證之需求，將依據既定之「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」辦理，並依照相關法令規定進行資訊公告。

此外，截至年報刊印日止，本公司尚未從事衍生性金融商品交易，惟未來若因業務發展或避險需求而有相關交易需求，亦將遵循「從事衍生性商品交易處理程序」及「取得或處分資產處理程序」，確保交易過程符合公司治理與風險控管原則，並依法令規定公開各項交易資訊，以維護股東權益及財務穩健性。

## (三) 未來研發計畫及預計投入之研發費用：

本公司未來研發計畫將持續聚焦於人工智慧(AI)影像辨識與先進封裝設備技術之發展，藉由導入機器學習(Machine Learning)演算法與國際知名品牌之人工智慧(AI)開發環境，以提升產品缺陷判讀之準確度與自動化程度。機器學習係透過既有影像資料訓練模型，以建立判定邏輯並應用於產品瑕疵檢測，能有效改善傳統演算法在非典型缺陷模式下之識別準確性。

### 1. AI 視覺檢測系統開發

本公司將以提升影像辨識能力為目標，持續推動兩項人工智慧(AI)應

用方案：

(1)AI OCR (Optical Character Recognition) 系統：應用於字元識別與標示檢測，提升產品標示判讀準確性與自動化程度。

(2)AI WBI (Wire Bond Inspection) 系統：應用於導線鍵合 (Wire Bond) 缺陷之自動檢測，以強化封裝製程品質監控與可靠度。

## 2. 先進封裝設備技術開發

本公司亦同步投入於晶圓堆疊整合製程 (CoWoS) 相關之封蓋／植片系統研發。由於先進封裝 IC 於高效能運算 (HPC) 應用中對散熱需求日益提升，需藉由導入金屬蓋或銅片 (Indium Foil) 作為導熱介質，以確保封裝穩定性與效能。

系統主要開發架構如下：

(1)框膠塗佈。

(2)散熱膏塗佈。

(3)封蓋對位與預壓合。

(4)封蓋熱壓合。

(5)視覺檢測與品質驗證。

## 3. 研發經費投入與規劃

為落實上述研發計畫並強化技術基礎，本公司預計每年編列固定比例之營收作為研發經費，持續投入於 AI 檢測系統及先進封裝設備之開發。未來將依營運規模與獲利狀況，適度擴充研發支出，以確保本公司於半導體產業設備領域之長期技術領先與市場競爭優勢。

### (四)國內外重要政策及法律變動對公司財務業務之影響及因應措施：

本公司運營遵循主管機關相關法令規範，並持續關注國內外政策發展趨勢及法規變動，以確保對市場環境變化的即時掌握，提供經營階層決策參考，並適時採取應對措施。對於可能影響公司營運的重要政策與法令變動，本公司均積極諮詢相關專業人士意見，適時調整營運策略，以確保業務穩健發展。截至年報刊印日止，本公司已對國內外重要政策及法律變動採取適當因應措施，並未有因國內外重要策略及法律變動對財務業務產生重大影響。

### (五)科技改變 (包括資通安全風險) 及產業變化對公司財務業務之影響及因應措施：

#### 1. 產業技術與市場變化之影響

(1)先進製程與封裝技術演進。

(2)隨著摩爾定律逐漸逼近極限，半導體產業已由製程微縮轉向先進封裝技術 (如晶圓上晶圓堆疊整合製程 (CoWoS)、矽上異質整合技術 (SoIC)、矽光子共同封裝 (CPO)、扇外型封裝 (Fan-out) 及小晶片模組化設計 (Chiplet))，以滿足人工智慧 (AI)、高效能運算 (HPC)、第五代行動通訊 (5G)、車用電子及物聯網 (IoT) 等應用之高速、高頻寬及高

散熱需求。此趨勢推動設備與材料需求持續升級，對公司產品組合與研發方向帶來挑戰與機會。

- (3) 應用市場快速成長與多元化。
- (4) 人工智慧 (AI)、高效能運算 (HPC)、電動車與智慧駕駛需求大幅攀升，帶動功率半導體、感測器與高頻通訊晶片需求增加。產業結構由標準化產品逐漸轉向客製化與系統整合解決方案，公司需投入更多研發與技術支援資源，以滿足客戶差異化需求。
- (5) 全球供應鏈區域化與競爭加劇。
- (6) 國際地緣政治風險與供應鏈重組，使得半導體設備與材料市場呈現區域化發展，客戶更加重視在地供應與即時服務。本公司若未能及時調整布局，將面臨市場競爭力下滑之風險。

## 2. 資通安全風險之影響

- (1) 營運面：公司日常營運高度依賴資訊系統進行供應鏈管理、客戶訂單、技術支援及跨國協作，如遭受駭客攻擊、惡意軟體或資料外洩，可能導致營運中斷、交期延誤或商譽受損。
- (2) 財務面：資安事故可能造成額外修復成本、罰款及法律訴訟支出，並影響客戶信任與後續合作，間接衝擊營收。
- (3) 技術與智慧財產權：若客戶機密資料或公司研發設計外洩，將嚴重損害技術競爭優勢，並可能導致潛在商機流失。

## 3. 財務與業務影響

### (1) 財務影響：

- ◆ 研發投入增加：因應先進製程與客製化需求，公司需持續增加研發支出，短期內可能壓縮獲利率。
- ◆ 營運成本上升：在地化佈局、資安防護及供應鏈管理將增加營運成本。
- ◆ 零件與材料價格波動：上游原物料及零組件成本變動，可能影響毛利結構。

### (2) 業務影響：

- ◆ 產品生命週期縮短：隨著技術演進加快，產品更新迭代頻率增加，公司需加快研發與客製化速度，以避免市佔率流失。
- ◆ 客戶需求轉變：客戶更重視整合方案與在地化服務，若公司未能提供完整解決方案，可能影響訂單。
- ◆ 國際市場波動：若地緣政治風險升高，跨國業務可能受限，影響市場拓展。

## 4. 因應措施

### (1) 技術與產品策略

- ◆ 持續強化自製產品研發，聚焦於高頻高速測試插座 (Socket)、低熱阻 IC 載具 (Tray)、自動化模組等高附加價值產品。

- ◆ 與國際原廠合作，導入先進封裝與測試技術（如小晶片模組化測試（Chiplet Test）、扇外型封裝（Fan-out）系統），確保產品線符合未來產業趨勢。
- ◆ 建立產品快速迭代與客製化平台，縮短導入週期。

#### (2)市場與營運策略

- ◆ 深化台灣與中國市場據點，積極拓展東南亞市場，分散區域風險。
- ◆ 建立「應用工程團隊」及「聯合工程小組」，提供客戶製程驗證與良率改善支援。
- ◆ 建立跨部門產品管理與企業資源規劃系統（ERP），提升營運效率與成本管控。

#### (3)資通安全管理

- ◆ 建立資安防護體系，涵蓋資安稽核、入侵偵測、資料備份與異地災難復原。
- ◆ 強化內部員工資安教育訓練，降低社交工程與操作風險。

#### (4)財務與風險管理

- ◆ 建立研發與資本支出規劃機制，平衡研發投入與財務穩健。
- ◆ 採取多元供應商策略，降低單一來源供應風險。
- ◆ 建立風險預警與情境模擬制度，強化公司對產業波動與市場突發事件的韌性。

整體而言，半導體產業技術快速變化與資安風險對公司營運確實構成挑戰，但同時亦帶來發展新商機。本公司將透過持續研發、強化在地化服務、健全資安防護及穩健財務管理，不僅降低潛在風險，更把握人工智慧（AI）、高效能運算（HPC）、車用電子與先進封裝市場成長契機，確保公司財務穩健與長期競爭優勢。

#### (六)企業形象改變對企業危機管理之影響及因應措施：

本公司自成立以來，秉持誠信的經營原則，專注於本業經營，遵守相關法令規定。積極強化內部管理，提升管理品質及績效，並保持和諧之勞資關係，以維持優良企業形象。最近年度及截至年報刊印日止，並無因企業形象改變而造成營運危機之情事。

#### (七)進行併購之預期效益、可能風險及因應措施：

本公司於最近年度及截至年報刊印日止，並無進行併購他公司之計畫。未來若有併購需求，將嚴格遵循當地法令規定及本公司制定之相關管理辦法，以確保交易過程合法合規，並以保障公司利益及股東權益為首要考量，審慎評估併購策略，確保企業長遠發展與競爭優勢。

(八)擴充廠房之預期效益、可能風險及因應措施

本公司最近年度及截至公開說明書刊印日止，尚無具體擴充廠房計畫。然因應公司整體營運規模持續成長，考量經營策略及產能配置規劃等，未來有擴充廠房計畫時，將經過審慎的評估過程，考量投資效益與風險，按本公司內部控制制度及相關管理辦法規定辦理，以確保全體股東之權益。

(九)進貨或銷貨集中所面臨之風險及因應措施：

1. 進貨方面

本公司進貨主要包含代理類商品與自製產品類所需之加工產品與零配件。與各代理類商品供應商均維持長期穩定且良好的合作關係，並簽署相關銷售合約保障進貨安全；並逐步建立多元商品與供應來源，以避免單一商品集中之風險。自製產品的配合加工廠商與零部件供應商方面，本公司有長期合作且完整建全的加工廠商體系，保障加工類商品的品質與交期穩定，並具備急單應變的彈性。同時密切注意原料供應市場供需變化，並積極開發新供應商，以厚植供應體系抗風險能力。

在供應商管理方面，定期供應商評估計畫，使用報表數據分析品質、成本、交期及強化供應穩定性與價格談判能力，並建立前瞻的供應商風險管理。

同時，營運單位密切交流合作提升效率與透明度制定應急計畫與即時回饋，在瞬息萬變的經濟環境下能掌握市場趨勢。

2. 銷貨方面

本公司銷售對象主要為國內半導體、光電、封裝測試製造業等均為知名大廠及上市櫃公司，於 113 年及 114 年最大銷售客戶占當年度銷貨收入比例分別為 11%及 10%，本公司除設備、零件、材料銷售外，亦積極投入設備製造領域，藉此分散產品結構，亦致力於擴展海內、外不同產品別客戶，避免銷貨集中之情形。

(十)董事、監察人或持股超過百分之十之大股東，股權之大量移轉或更換對公司之影響、風險及因應措施：

最近年度及截至年報刊印日止，本公司董事、監察人或持股超過百分之十之大股東，未有股權大量移轉或更換而對本公司營運產生重大影響之情事。

(十一)經營權之改變對公司之影響、風險及因應措施：

最近年度及截至本年報刊印日止，本公司並無經營權改變之情事。

(十二)訴訟或非訟事件：

1. 公司最近二年度及截至年報刊印日止已判決確定或目前尚在繫屬中之訴訟、非訟或行政爭訟事件，其結果可能對股東權益或證券價格有重大影響者應揭露其系爭事實、標的金額、訴訟開始日期、主要涉訟當事人及目前處理情

形：無。

2. 公司董事、監察人、總經理、實質負責人、持股比例超過百分之十之大股東及從屬公司，最近二年度及截至年報刊印日止已判決確定或目前尚在繫屬中之訴訟、非訟或行政爭訟事件，其結果可能對公司股東權益或證券價格有重大影響者：無。
3. 公司董事、監察人、經理人及持股比例超過百分之十之大股東，最近二年度及截至年報刊印日止發生證券交易法第一百五十七條規定情事及公司目前辦理情形：無。

(十三)其他重要風險及因應措施：無

**七、其他重要事項：無**

## 陸、特別記載事項

### 一、關係企業相關資料：

請參閱本公司於公開資訊觀測站（新版 MOPS）之公告申報，  
索引路徑：公開資訊觀測站>單一公司>電子文件下載>關係企業三書表專區  
網址：[https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/t57sb01\\_q10](https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/t57sb01_q10)

### 二、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形：無

### 三、其他必要補充說明事項：無

### 四、最近年度及截至年報刊印日止，如發生本法第三十六條第三項第二款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項：

本公司於 115 年 2 月 11 日股東臨時會決議通過依證券交易法第 14 條之 4 規定改由全體獨立董事組成審計委員會以取代監察人，並將董事席次自 5 席增加至 7 席（含獨立董事 3 席），本公司原任董事張睿政、邱哲儀及原任監察人李復華、冠兆投資股份有限公司為配合公司選任獨立董事以符合公司法、證交法及其他相關法令規定，於 115 年 2 月 11 日股東臨時會辭任董事及監察人職務，並於該次股東臨時會補選劉慧儀、洪欣儒、胡瑞卿等 3 席獨立董事及張添昌 1 席董事，並由全體獨立董事組成審計委員會以取代監察人，且審計委員會自獨立董事選任時成立，故該次股東臨時會不另行選任監察人。本次董事及監察人之變動，主要係審計委員會之設置為國際趨勢，亦為公司治理之重要指標及公司未來業務發展之需求，且林斯穎董事仍持續擔任瀚軒股份有限公司董事長、陳文冠董事仍持續擔任瀚軒股份有限公司總經理，對本公司經營方針及決策應不致產生重大變動，對本公司民國 114 度財務報告並無重大不利影響，無須作重大修正，且對股東權益及證券價格亦無重大影響。

瀚軒股份有限公司



董事長：林斯穎

